Electronics for the Future

決算説明会　2025年度 通期業績

ローム株式会社
代表取締役社長　東 克己
2026年5月13日

業績報告

© ROHM Co., Ltd.

決算ハイライト

（単位：億円）

	FY2025 通期実績		YoY	FY2026 通期計画		YoY
売上高	4,811	-	+7.3%	5,100	-	+6.0%
営業利益	108	2.3%	-	300	5.9%	+176.1%
純利益	▲1,584	▲32.9%	-	290	5.7%	-
期中平均レート(¥/US$)	(150.97円)			(153.53円)		

FY2025実績	金価格高騰による変動費負担の増加があったものの、売上増や償却費を中心とする固定費削減の効果により、前年度の営業赤字から黒字に転換。しかし、SiC事業の固定資産を中心に減損損失を計上した結果、当期純損失は大きく拡大。
FY2026計画	構造改革の効果が徐々に現れてくるものの、中東情勢や更なる金価格高騰の影響で効果は限定的に。しかし、FY25で計上した減損損失の影響により償却費が大きく減少し、営業利益は大きく改善。
今後の在庫方針	原材料を中心に全体として圧縮を継続。FY26末において回転月数6カ月以下を目指す。
配当	期末配当は1株当たり25円の予定で中間配当と合わせて年間配当は50円。FY26も同額の予定。
事業・経営統合の進捗	東芝D&Sの半導体事業との統合に向けてDDを開始。 三菱電機パワーデバイス事業との統合に関しては、並行して協議中。

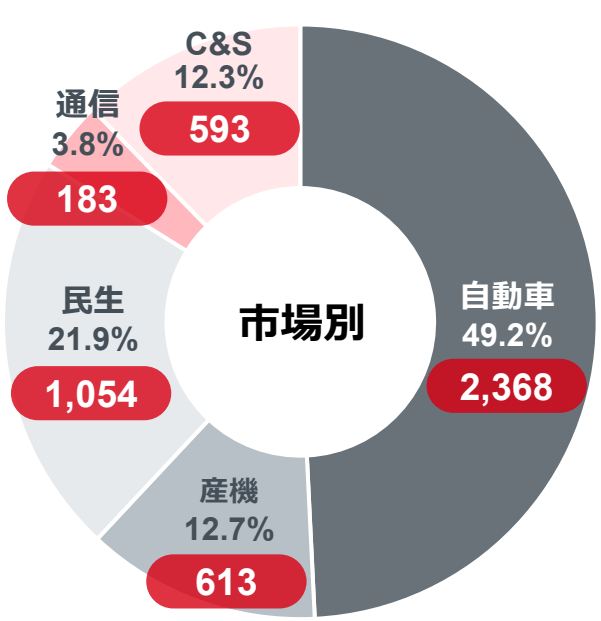
© ROHM Co., Ltd.

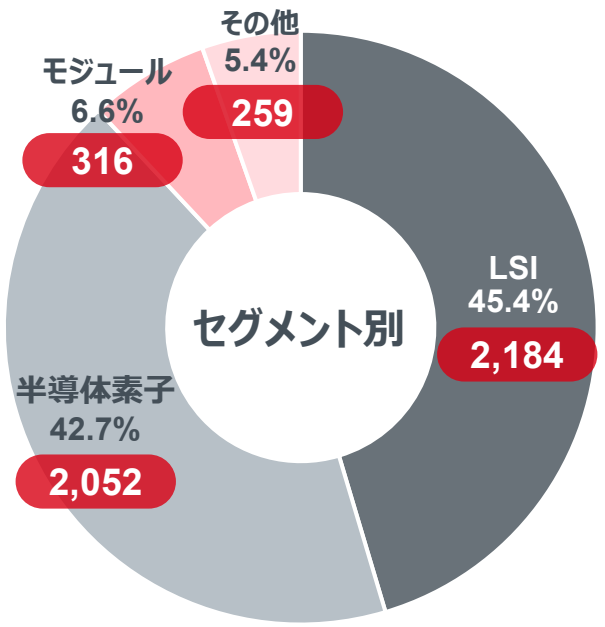
［2025年度 通期実績］売上構成比

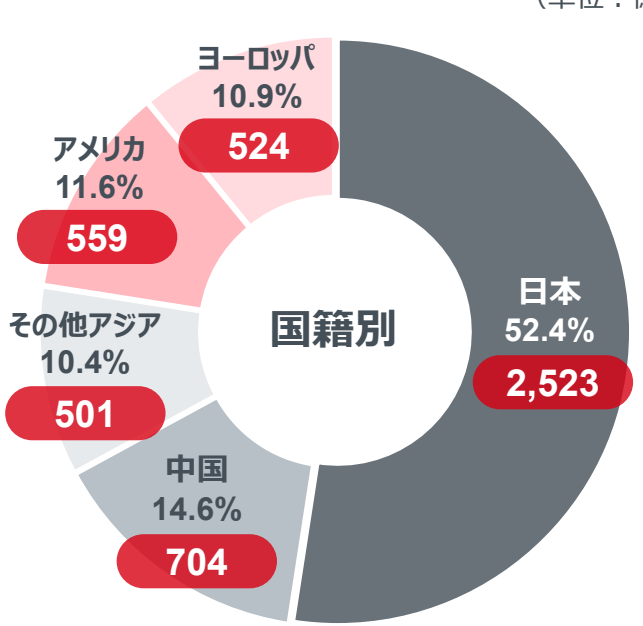
2024年度 通期 4,484億円

2025年度 通期 4,811億円 YoY +7.3%

（単位：億円）







市場	YoY
自動車	+5.8%
産機	+7.0%
民生	+13.0%
通信	▲7.0%
C&S	+8.9%

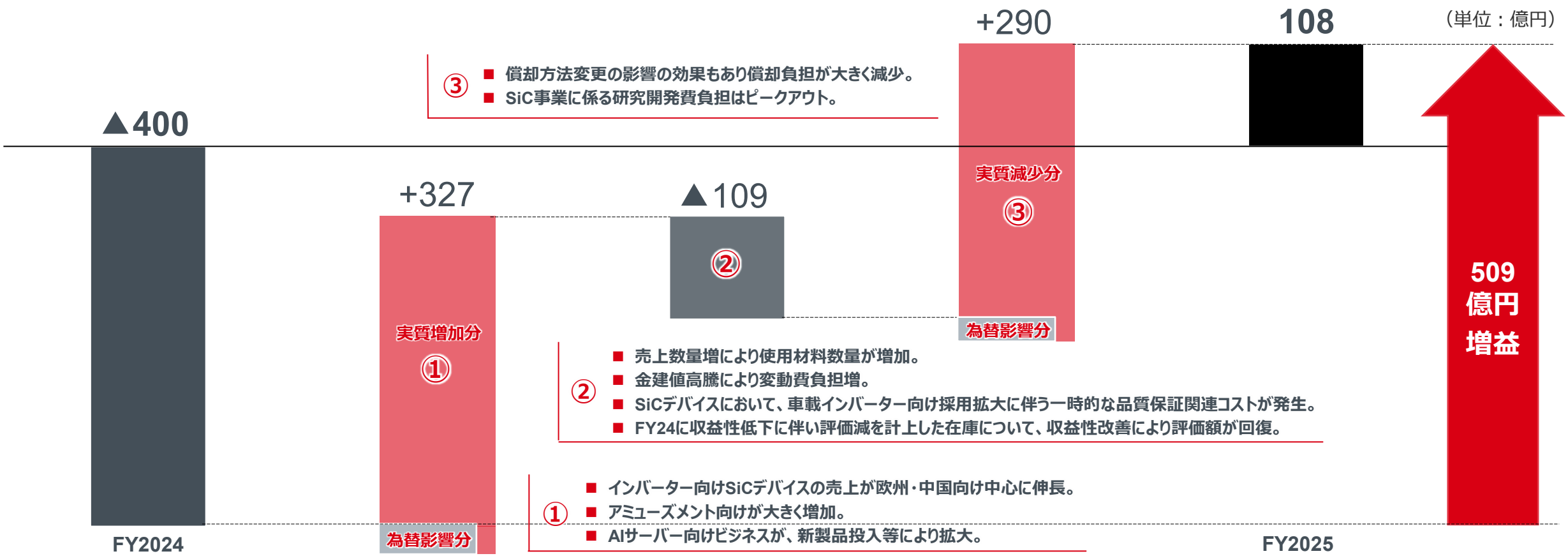
セグメント	YoY
LSI	+7.1%
半導体素子	+9.7%
モジュール	▲3.0%
その他	+3.6%

国籍	YoY
日本	+7.6%
中国	+5.1%
その他アジア	+10.6%
アメリカ	+3.6%
ヨーロッパ	+9.8%

© ROHM Co., Ltd.

［2025年度 通期実績］営業利益 増減分析（YoY）

（単位：億円）



FY2024
実績
（152.48円/US$）

③
- 償却方法変更の影響の効果もあり償却負担が大きく減少。
- SiC事業に係る研究開発費負担はピークアウト。

②
- 売上数量増により使用材料数量が増加。
- 金建値高騰により変動費負担増。
- SiCデバイスにおいて、車載インバーター向け採用拡大に伴う一時的な品質保証関連コストが発生。
- FY24に収益性低下に伴い評価減を計上した在庫について、収益性改善により評価額が回復。

①
- インバーター向けSiCデバイスの売上が欧州・中国向け中心に伸長。
- アミューズメント向けが大きく増加。
- AIサーバー向けビジネスが、新製品投入等により拡大。

FY2025
実績
（150.97円/US$）

売上増加	+327
為替影響	▲29
実質増加	+356

市場別内訳

自動車	+131	通信	▲14
産機	+40	C&S	+49
民生	+121		

材料費及び在庫の影響	▲109
材料費	▲268
在庫の影響	+159

固定費の減少	+290
為替影響	▲23
実質減少	+313

製造原価

労務費	▲14
償却費	+211
経費	▲6

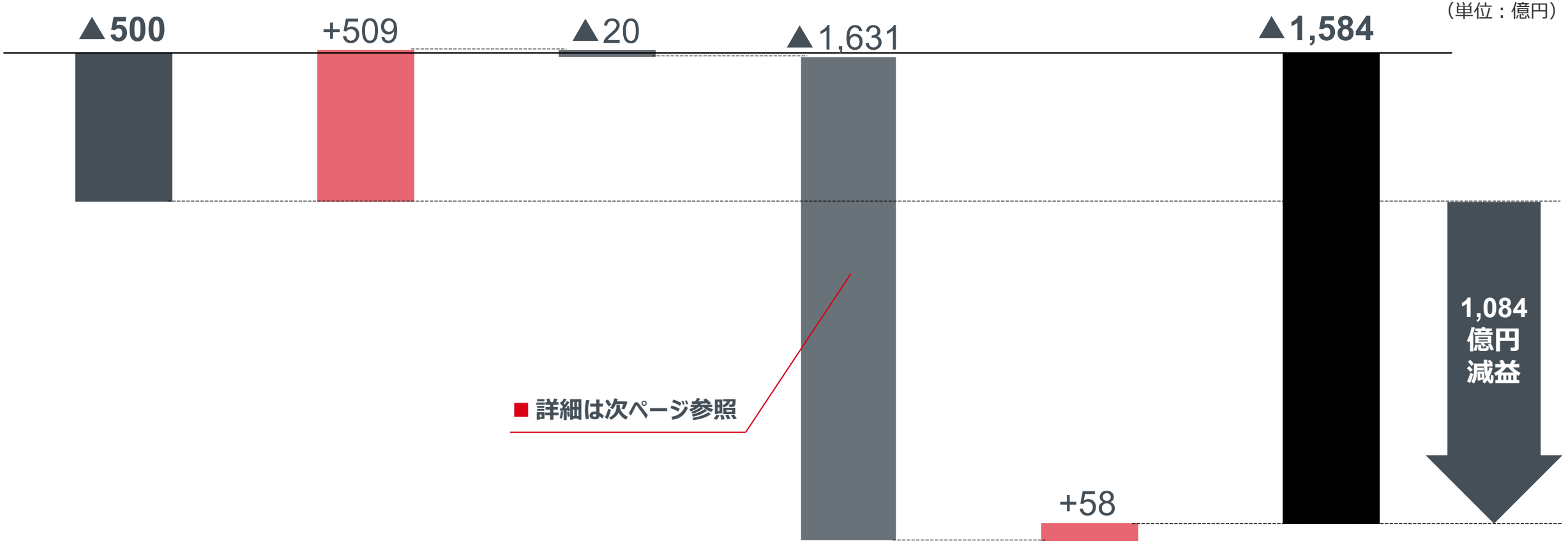
販管費

研究開発費	+106
その他	▲7

© ROHM Co., Ltd.

[2025年度 通期実績] 当期純利益 増減分析（YoY）

（単位：億円）



営業利益影響	+509
詳細はP5参照	

営業外損益影響	▲20
受取利息・配当金	▲16
為替差損益	▲13
その他	+9

特別損益影響	▲1,631
減損損失	▲1,632
その他	+1

法人税等影響	+58
税前利益増減影響(標準税率)	+348
評価性引当額	▲322
その他	+32

固定資産減損損失の計上について

減損損失計上の経緯

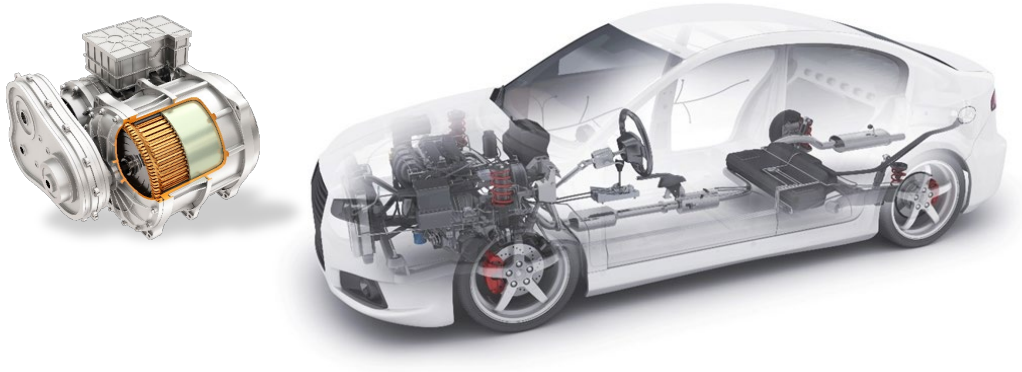
マクロ環境の変化

■ **BEVの成長鈍化**

BEVの市場予測のピークは2023年であり、それ以降継続的に下方修正を続けてきた。

直近では、米国のガソリン車への回帰や、日本でのBEV開発の後ろ倒しなど環境が大きく変化。

FY25に策定した中期経営計画では、上記市況の変化を織り込んだ、より堅実なSiC事業の売上目標を設定。



ロームを取り巻く経営環境の変化

■ **先行投資による過剰投資**

SiC事業が将来の成長ドライバである点に変化はないが、これまでの投資額と市場成長に乖離が出ており、投資回収期間の長期化が不可避な状況。

■ **中国製SiCデバイスの台頭**

中国地場のSiCデバイスメーカーが、価格面で攻勢を掛けてきており、中国市場でのシェアが低下。

■ **SiC基板外販ビジネスの縮小**

市場における供給過多により6インチ基板のニーズが低下。

© ROHM Co., Ltd.

［2026年度 通期計画］ローム売上見通しサマリ

市場	2026年度の見通し	1H	2H
自動車 (+5.6%)	■ 自動車生産台数は微増の見通しであり、ローム売上高も台数連動で推移する見立て。 ■ SiC基板の外販ビジネスが縮小する一方、SiCデバイスが欧州・日系顧客向け中心に大きく伸長。xEV分野の成長をけん引。	 +9.3%	 +2.2%
産機 (+5.0%)	■ 長期化していた顧客の在庫調整が概ね解消。FA中心に回復の見立て。	 +8.3%	 +1.7%
民生その他 (+6.8%)	■ 中国向け白物家電分野が、補助金終了に伴い減速する見通し。 ■ アミューズメント向けの売上は引き続き好調に推移する見通し。 ■ 市場の拡大や新製品の投入により、サーバー向けやストレージ向けの採用が拡大。	 +4.4%	 +9.7%

括弧内はローム売上高YoY

【YoY】
前年比


+10%～


+10%～+3%


+3%～▲3%


▲3%～▲10%


▲10%～

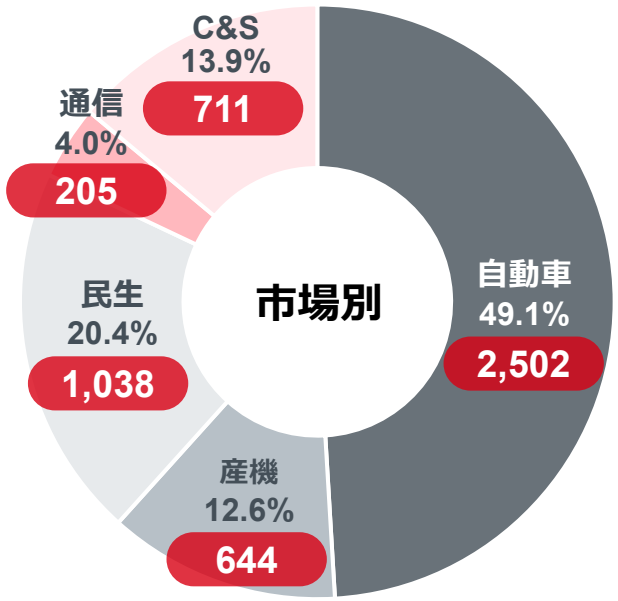
© ROHM Co., Ltd.

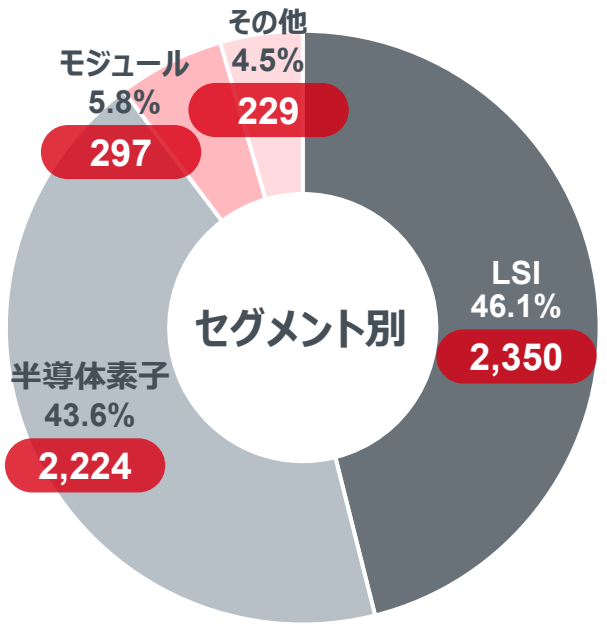
[2026年度 通期計画] 売上構成比

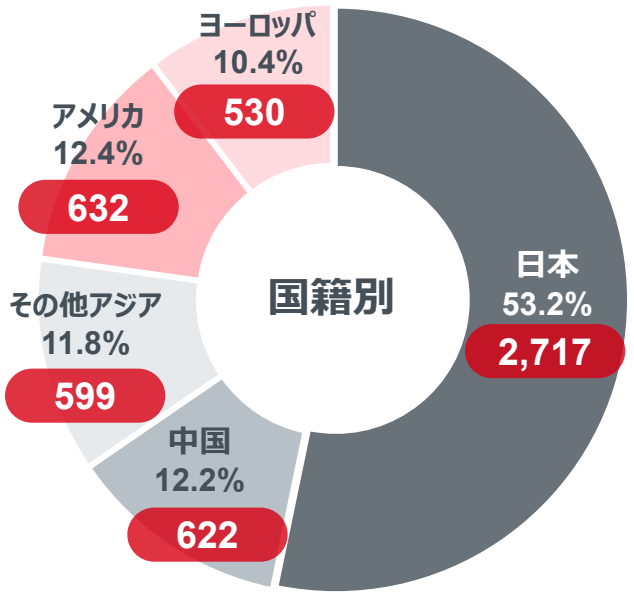
2025年度 通期 4,811億円

2026年度 通期 5,100億円 YoY +6.0%

（単位：億円）







市場	YoY
自動車	+5.6%
産機	+5.0%
民生	▲1.5%
通信	+12.2%
C&S	+19.9%

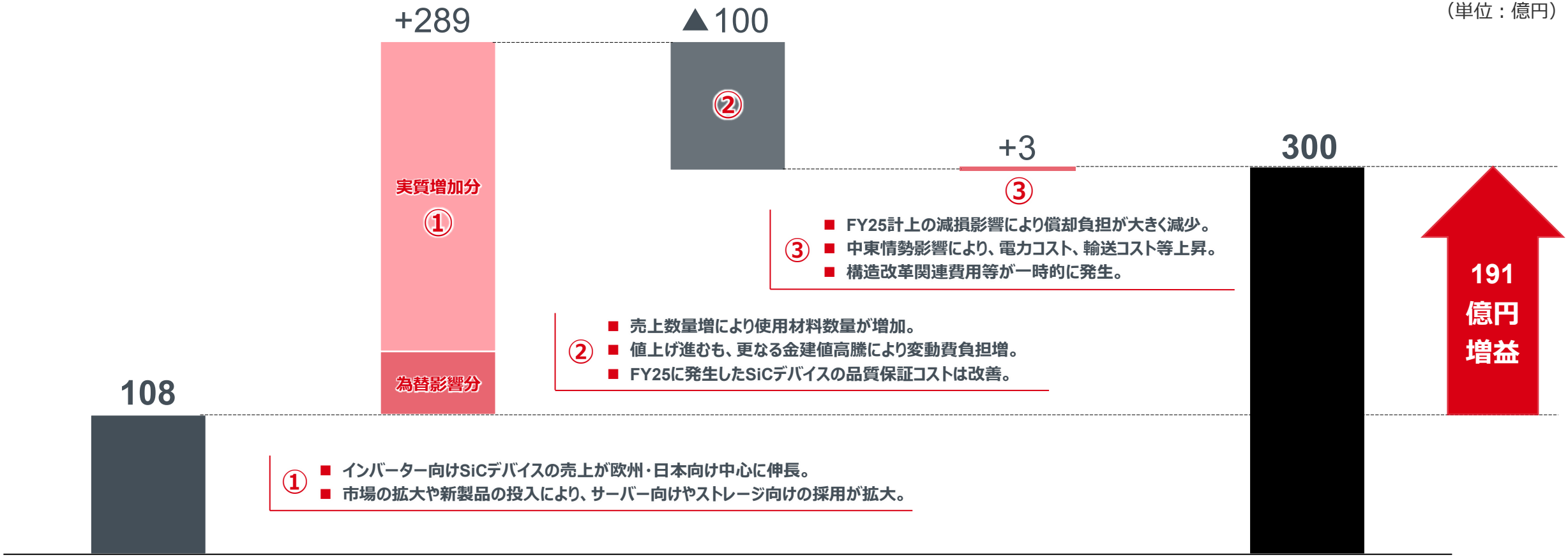
セグメント	YoY
LSI	+7.6%
半導体素子	+8.4%
モジュール	▲5.9%
その他	▲11.8%

国籍	YoY
日本	+7.7%
中国	▲11.7%
その他アジア	+19.7%
アメリカ	+13.0%
ヨーロッパ	+1.0%

© ROHM Co., Ltd.

［2026年度 通期計画］営業利益 増減分析（YoY）

（単位：億円）



FY2025 実績
（150.97円/US$）

売上増加	+289
為替影響	+49
実質増加	+240

市場別内訳

自動車	+133	通信	+22
産機	+31	C&S	+118
民生	▲16		

材料費及び在庫の影響	▲100
材料費	▲110
在庫の影響	+10

固定費の減少	+3
為替影響	▲3
実質減少	+6

製造原価

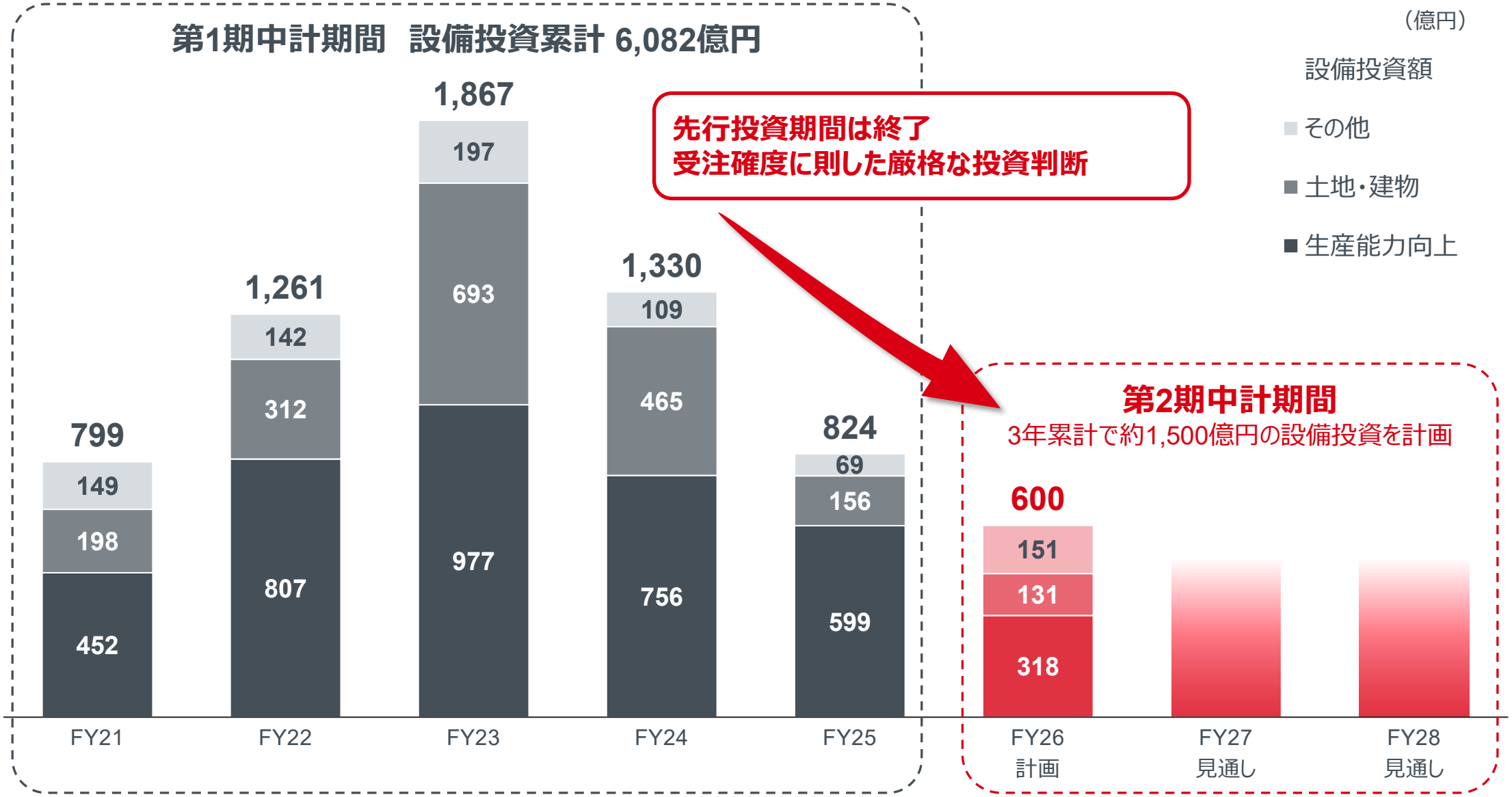
労務費	▲20
償却費	+154
経費	▲81

販管費

研究開発費	▲12
その他	▲37

FY2026 計画
（153.53円/US$）

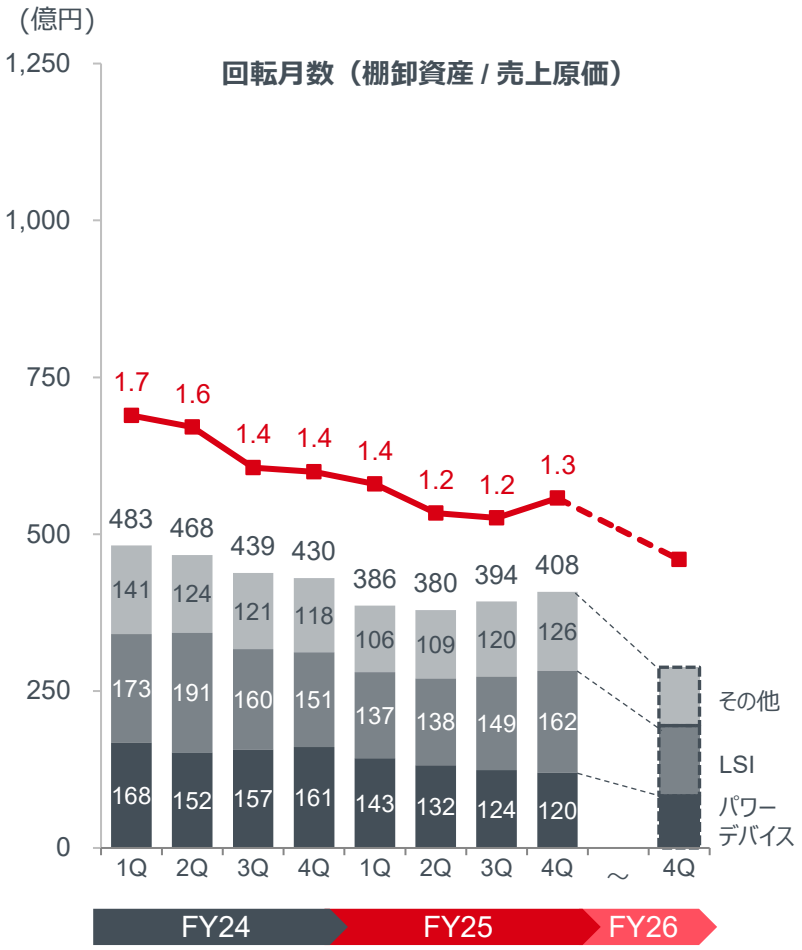
設備投資の状況


第1期中計期間　設備投資累計 6,082億円
（億円）
設備投資額
その他
土地・建物
生産能力向上
先行投資期間は終了
受注確度に則した厳格な投資判断
799
149
198
452
1,261
142
312
807
1,867
197
693
977
1,330
109
465
756
824
69
156
599
600
151
131
318
FY21
FY22
FY23
FY24
FY25
FY26
計画
FY27
見通し
FY28
見通し
第2期中計期間
3年累計で約1,500億円の設備投資を計画

在庫の状況

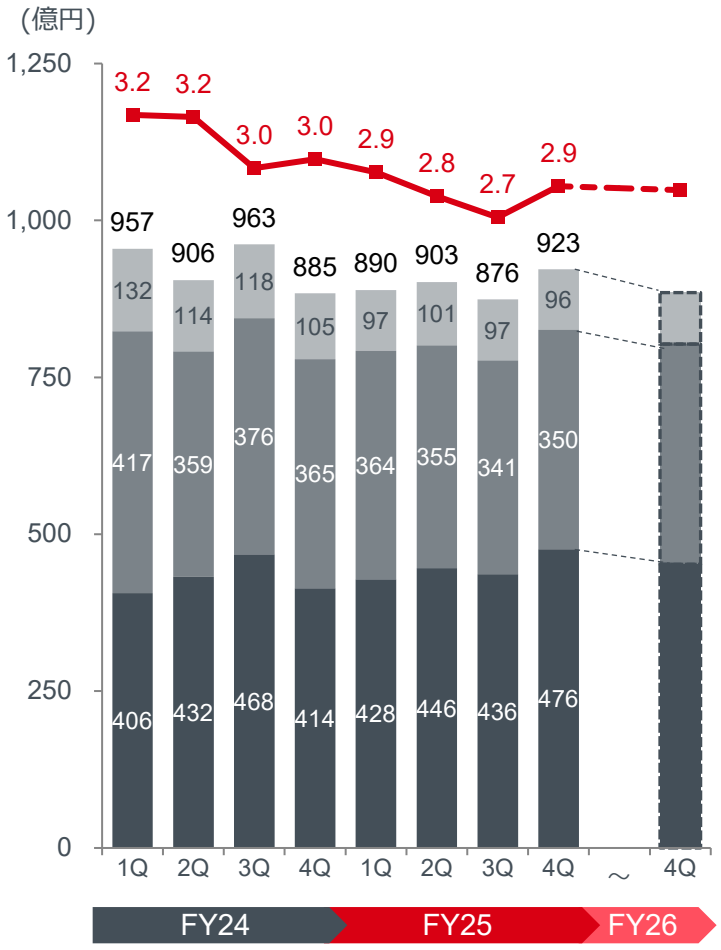
■ 商品及び製品

BCP在庫の基準を見直し、適正水準まで圧縮を進める。



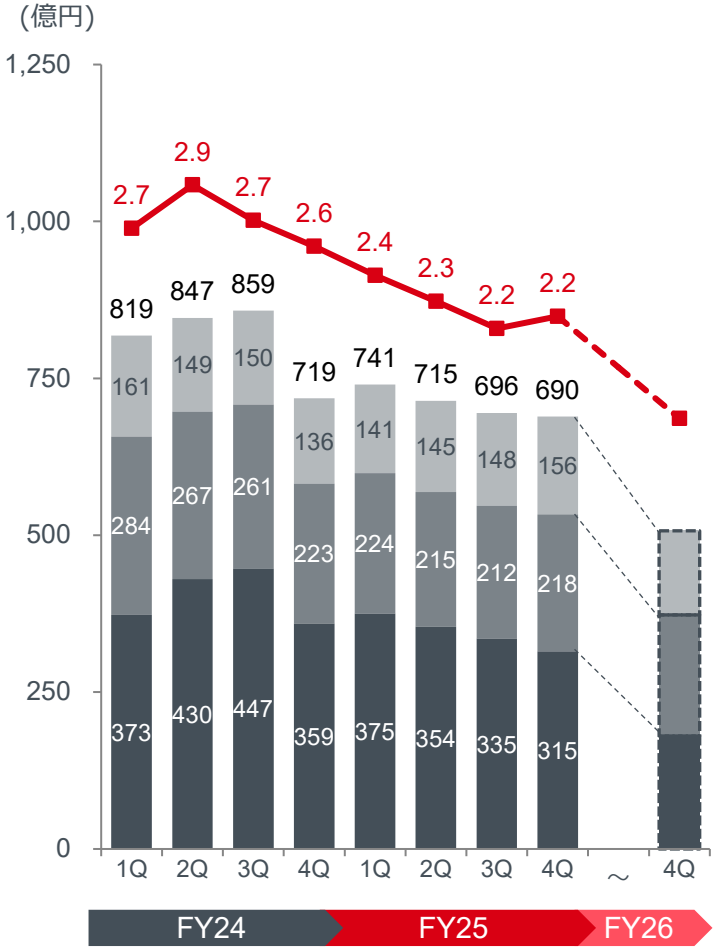
■ 仕掛品

生産リードタイムの短縮により、段階的に工程内在庫の圧縮を進める。



■ 原材料及び貯蔵品

LTAによる購入量を縮小し、新規購入量を抑制。現存在庫を確実に消費し圧縮を進める。

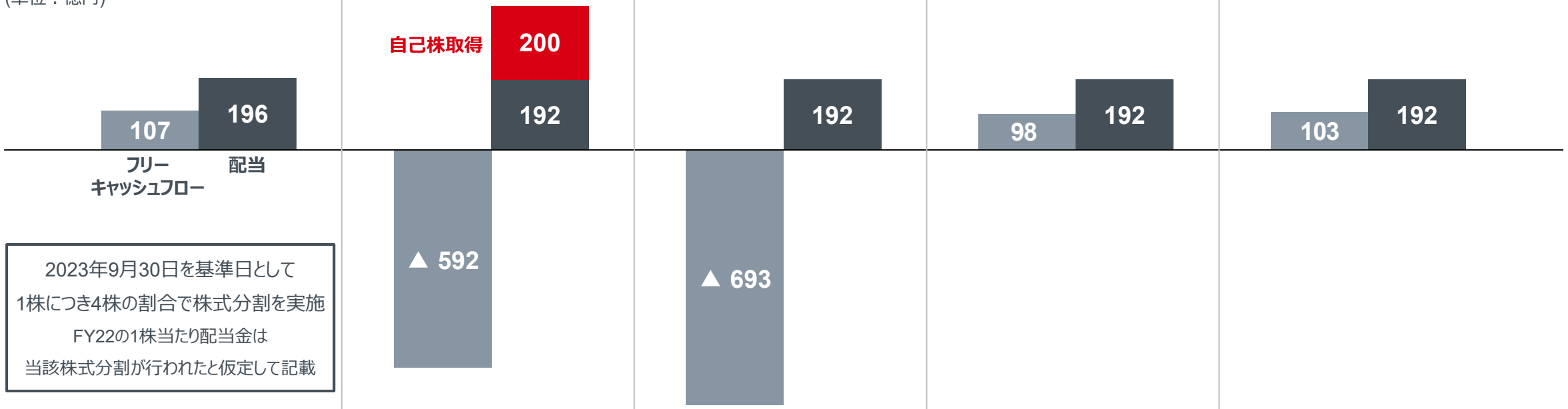


© ROHM Co., Ltd.

株主還元の推移

FY22		FY23		FY24		FY25		FY26（計画）	
配当性向	24%	配当性向	36%	配当性向	-%	配当性向	-%	配当性向	67%
総還元性向	24%	総還元性向	73%	総還元性向	-%	総還元性向	-%	総還元性向	67%

(単位：億円)



2023年9月30日を基準日として
1株につき4株の割合で株式分割を実施
FY22の1株当たり配当金は
当該株式分割が行われたと仮定して記載

FY22		FY23		FY24		FY25		FY26（計画）	
年間配当	50円	年間配当	50円	年間配当	50円	年間配当	50円	年間配当	50円
中間	25円	中間	25円	中間	25円	中間	25円	中間	-
期末	25円	期末	25円	期末	25円	期末	25円	期末	-

＊フリーキャッシュフロー：純利益 ＋ 減価償却費 ＋ 減損損失 － 設備投資

中期経営計画・構造改革

経営目標

財務目標 (2028年度)

売上高	5,000億円以上
営業利益	20%以上
ROE	9%以上

非財務目標 (抜粋)

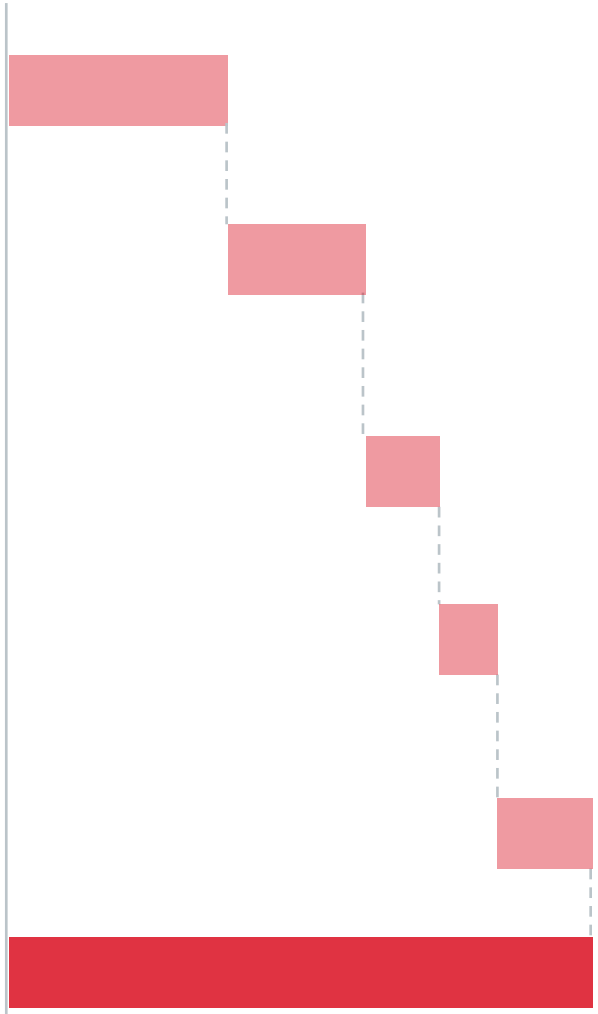
環境 (2030年度)	■ 温室効果ガス排出量50.5%削減 (2018年度比) ■ 再生可能エネルギー 2050年度導入比率100%へ向け推進 ■ 廃棄物ゼロエミッション化
人財戦略と 企業の 持続的成長	■ サクセッションプラン充足率　300% ■ 変革実行力教育　コア人材受講率100% ■ 株式報酬制度の拡充

構造改革 進捗

構造改革は実行フェーズに入り、利益改善が着実に顕在化

	完了、もしくは実行中の改革（一部抜粋） ※赤字はFY26の業績に寄与	FY25→FY28 利益改善額(計画)
SiC事業の収益性改善	■ デバイス第5世代投入、歩留まり改善 ■ 6インチから8インチ生産への早期移行 ■ 保有材料在庫最適化	340 - 400
生産拠点再編 事業ポートフォリオ適正化	■ **生産拠点再編** （国内2拠点 顧客申請済、海外1拠点 譲渡契約完了） ■ **不採算製品撤退・値上げ**（顧客申請中、FY27寄与） ■ **金→銅ワイヤへの切替え**（顧客申請中、FY27寄与）	180 - 220
製造コストダウン 調達コスト適正化	■ 生産性改善（一部の付帯設備の運用最適化完了） ■ 物流、倉庫コスト削減（一部地域での倉庫統合完了） ■ **電力調達コスト適正化（交渉完了）** ■ 主材料の原価低減 （一部ベンダーとの交渉完了）	90 - 120
価格適正化 業務効率改善	■ **Au高騰による価格転嫁（FY25 4Q～寄与）** ■ 新プライシング制度の導入開始 ■ 間接費用の低減	70 - 100
売上成長 (SiC事業除く)	■ トップライン成長 ■ **AIサーバ向け売上成長** ■ マーケティング組織再編によるAIサーバー向け体制強化	140 - 200
	FY2028営業利益改善額	**1,000**

（単位：億円）



生産拠点再編

前工程・後工程ともに再編の実行フェーズへ

9拠点

本社のLSI・トランジスタおよび笠岡のLSIは
他拠点に移管し、生産終了予定

前工程（ウエハ・デバイス製造）

本社（京都） 再編進行中
LSI　トランジスタ
センサ　LED
SiC　半導体レーザー

大津（滋賀）
トランジスタ
ダイオード
IGBT

ローム・デバイス マニュファクチャリング株式会社

笠岡（岡山） 再編進行中
LSI
ダイオード

宮崎（宮崎）
LSI　ダイオード　IGBT
センサ　SiC

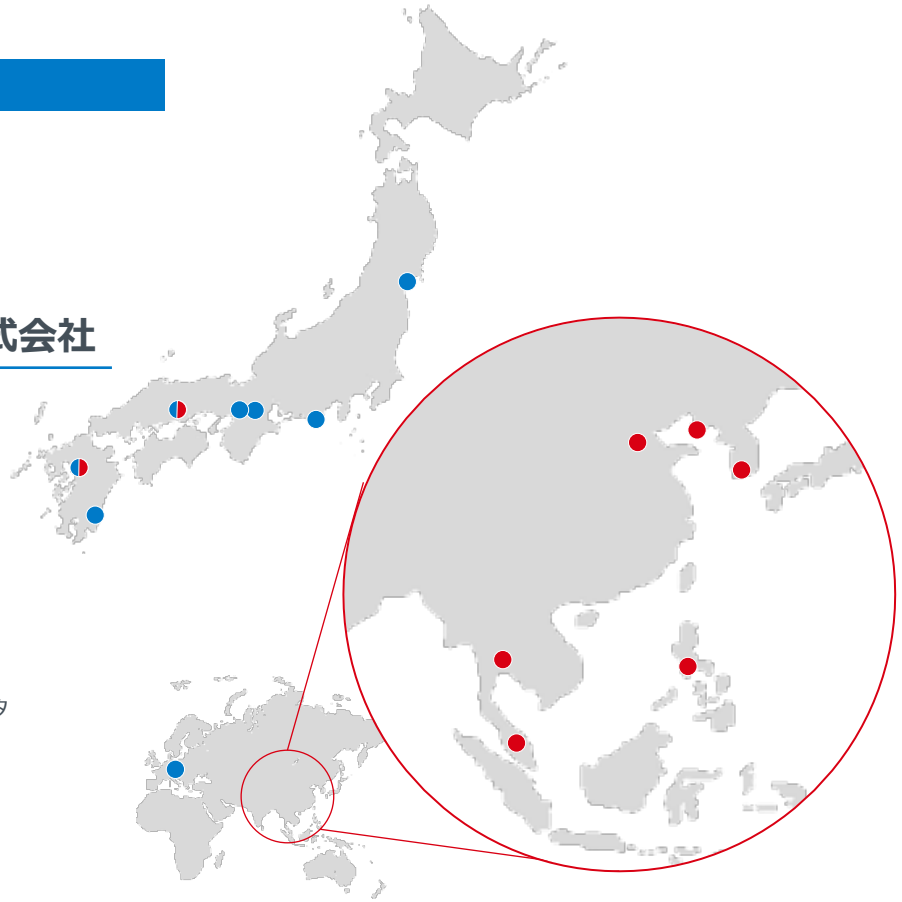
宮崎（国富）
SiC

宮城（大衡）
LSI

浜松（静岡）
LSI　GaN
LED

筑後（福岡）
LSI　トランジスタ
ダイオード　SiC

SiCrystal GmbH（ドイツ） ※ウエハ製造



9拠点 ▶ 8拠点

大連工場の譲渡契約完了

後工程（組立・検査） マザー工場

ローム・アッセンブリ マニュファクチャリング株式会社

笠岡（岡山）
ダイオード　LED
半導体レーザー

広川（福岡）
センサ　トランジスタ
ダイオード　プリントヘッド

行橋（福岡）
LSI

後工程（組立・検査）

タイ
LSI　SiC　光センサ
トランジスタ　IGBT　抵抗器
ダイオード　IPM　ワイヤレスモジュール

マレーシア
トランジスタ　LED
ダイオード　LSI

フィリピン
LSI　抵抗器　トランジスタ
プリントヘッド　センサ　ダイオード

韓国
トランジスタ　SiC
ダイオード　IGBT

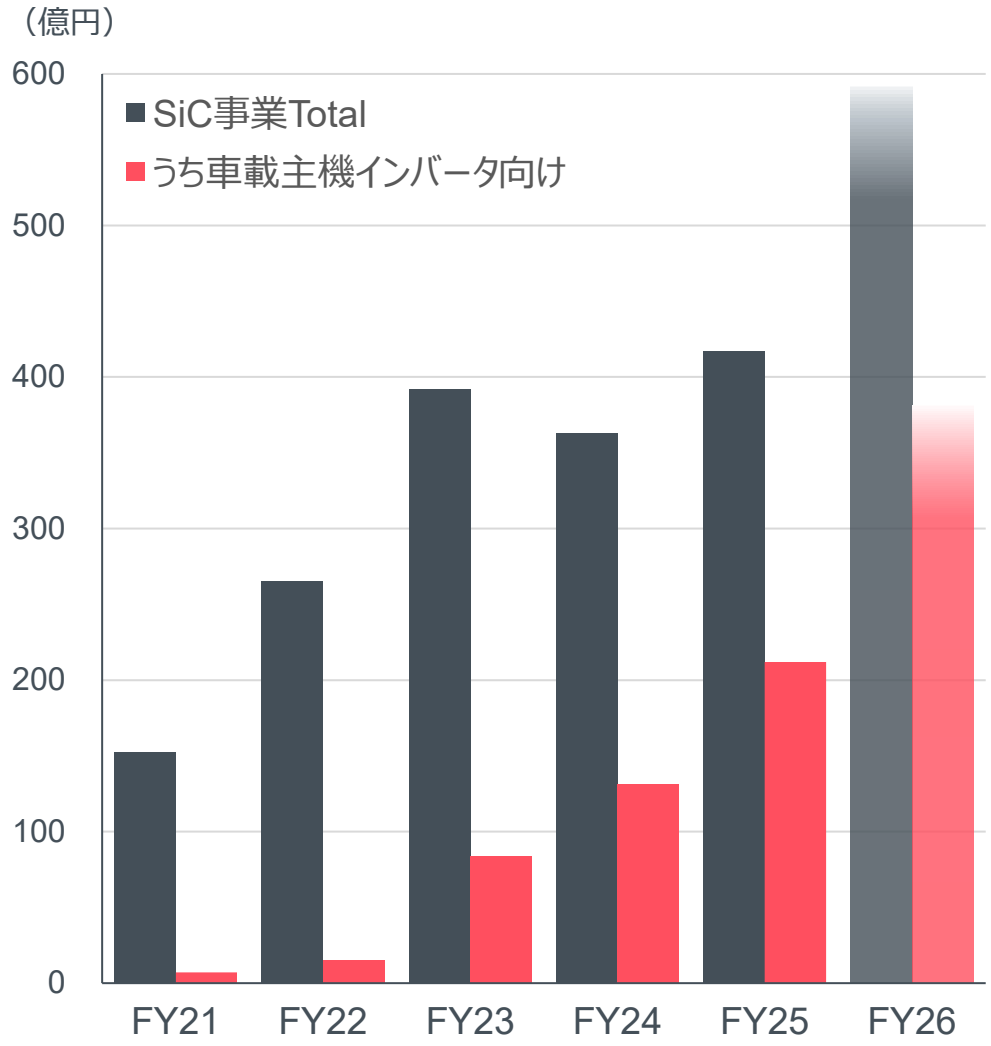
大連 譲渡契約完了
プリントヘッド

天津
ダイオード　半導体レーザー　光センサ
LED　LEDディスプレイ

SiC事業戦略

SiC事業の売上推移

■ SiC事業の売上推移



■ SiC事業の売上伸長率

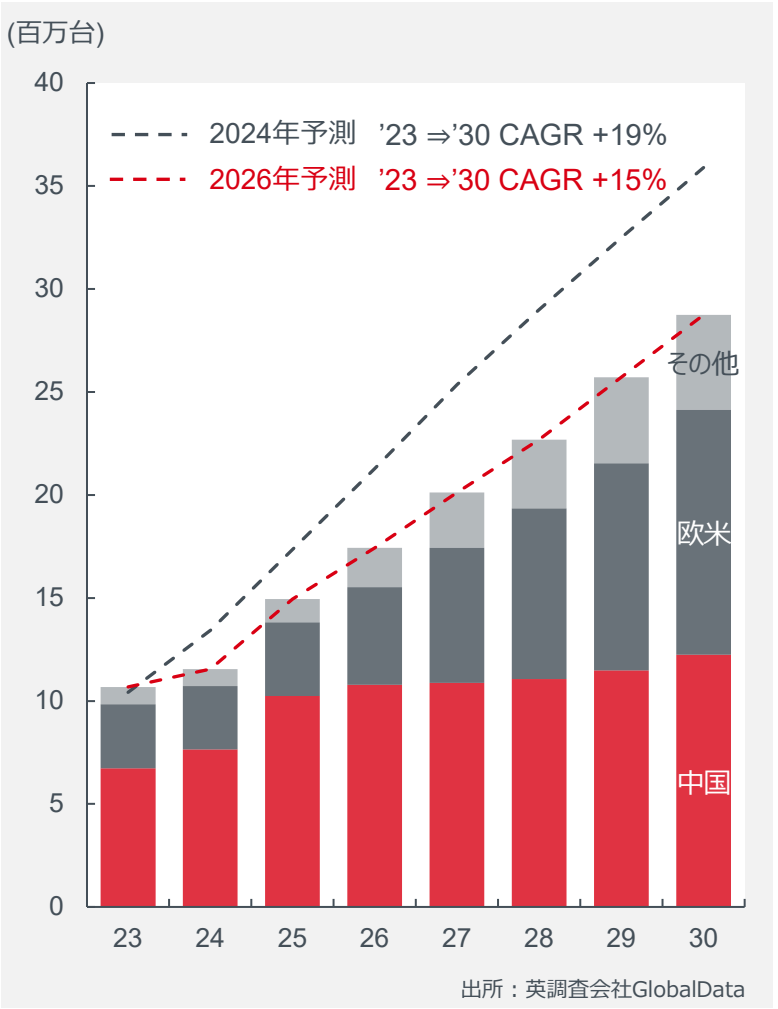
YoY	FY25	FY26
SiC事業	+14%	> +30%
SiCデバイス・モジュール事業 （SiC基板事業除く）	+41%	> +55%

- 車載インバータ向けが売上増を牽引
- コンピュータ・ストレージ（AIサーバー電源向け）分野の26年度売上は前年比2.5倍の成長を計画
- 第5世代SiC MOSFET 8インチ品で量産出荷を本格開始
- NEDO グリーンイノベーション基金事業の助成を受けた「8インチ次世代SiC MOSFETの開発」を計画比2年前倒しで完了
- 基板の外販ビジネスは、事業環境の変化を踏まえ縮小

© ROHM Co., Ltd.

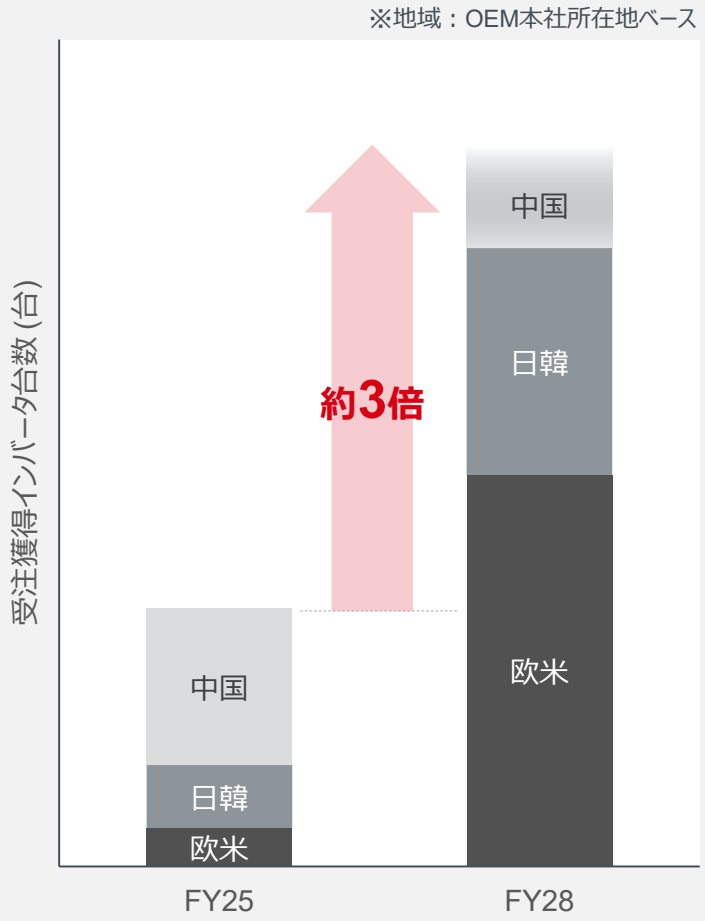
主機インバータ向けビジネスの状況

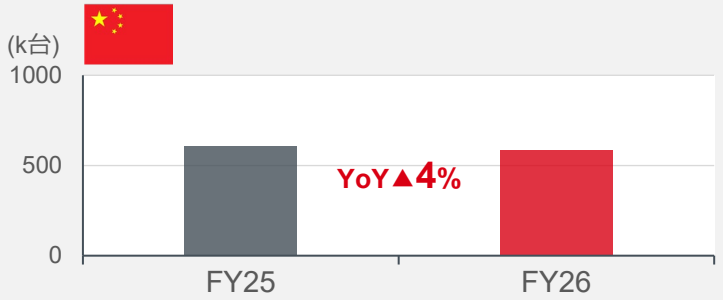
BEV生産台数 市場予測

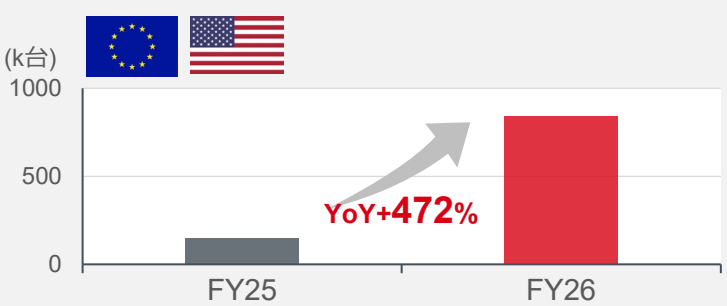


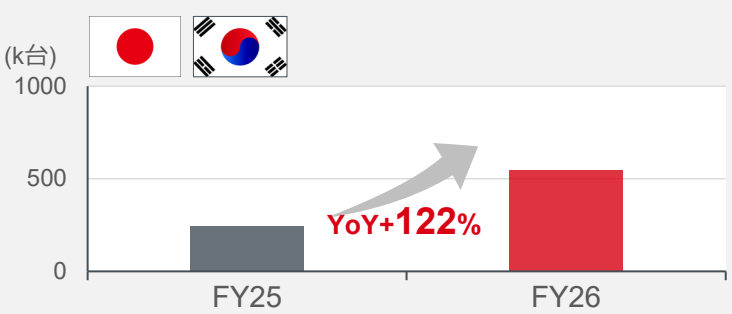
出所：英調査会社GlobalData

主機インバータ　OEM地域別 受注獲得状況





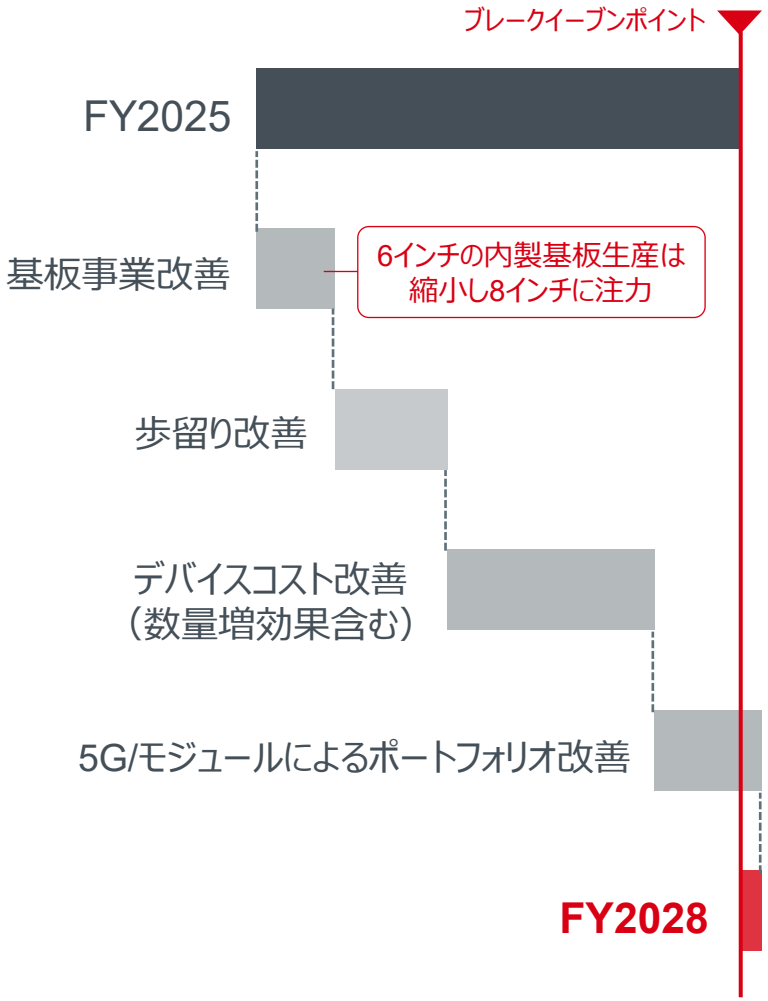




© ROHM Co., Ltd.

SiC事業の黒字化に向けた取り組み

黒字化への道筋



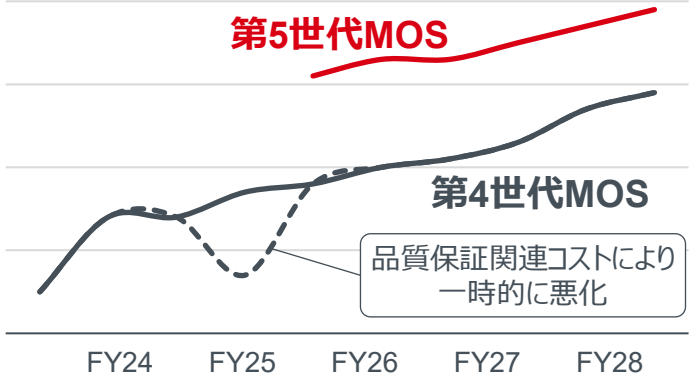
歩留まり改善

デバイス世代更新により改善を加速

第5世代SiC-MOSFETは、開発において素子構造の見直しや製造プロセスの最適化を図り、歩留まり改善にも大きく貢献

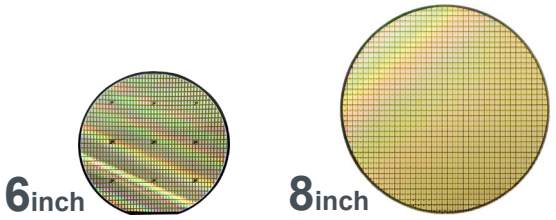
EcoSiC

■ 歩留まり（%）

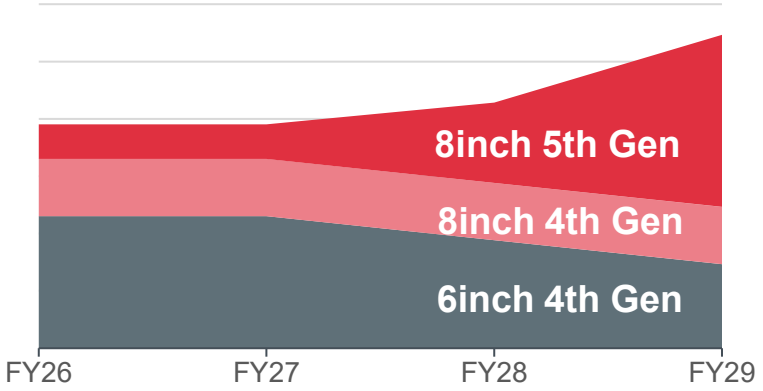


SiCデバイス 収益性改善・生産能力アップ

8インチ×第5世代デバイスの生産/売上比率を上げることで、生産能力アップと収益性の改善に大きく貢献



■ SiCデバイス生産能力

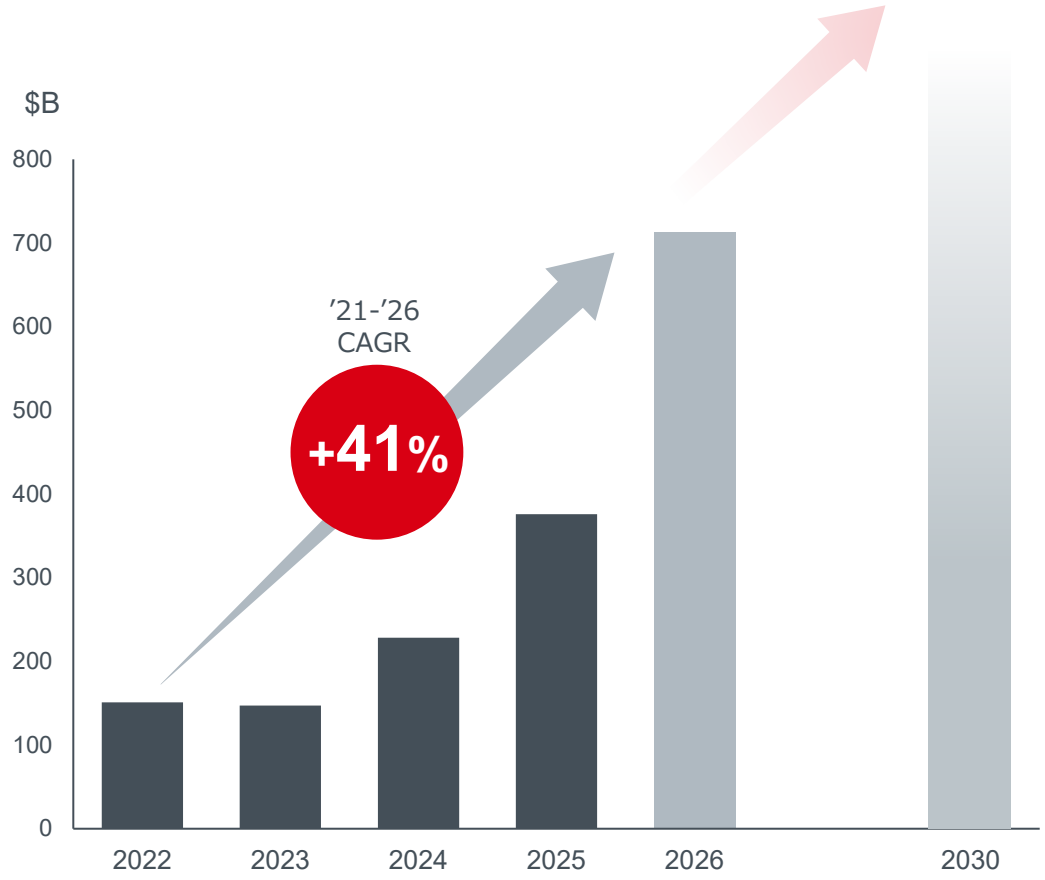


© ROHM Co., Ltd.

AIサーバー向けビジネスの進捗

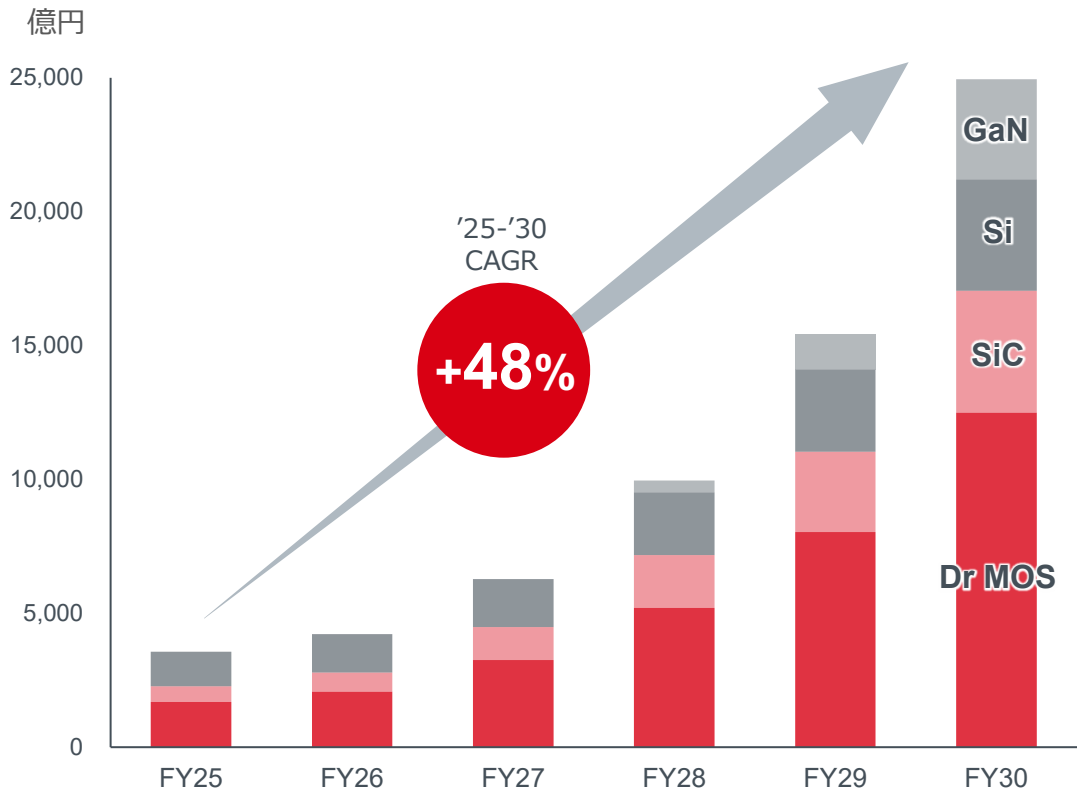
データセンター設備投資 ／ 需要予測

データセンター設備投資
（Amazon / Google / Microsoft / META）



出所：各社IR情報を元にローム作成

AIサーバー向けPower Device（Dr MOS含む）需要予測

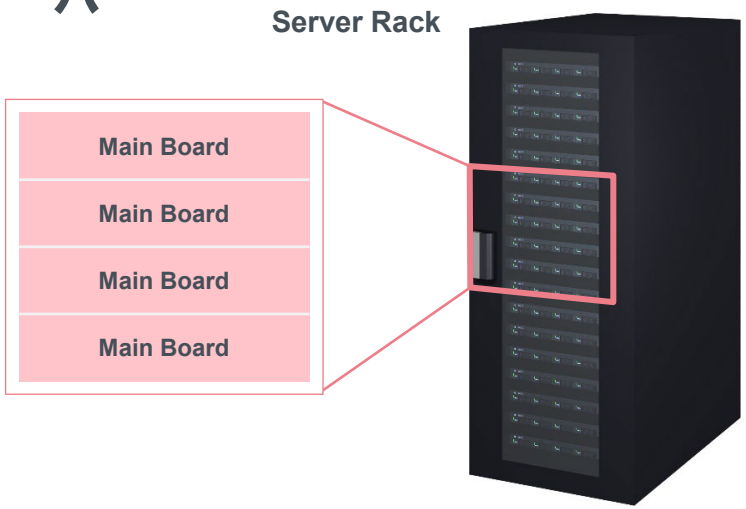


出所：ローム調べ

AIサーバーの進化

サーバー構成の進化に伴いPower＆Analogデバイスの員数が飛躍的に増大

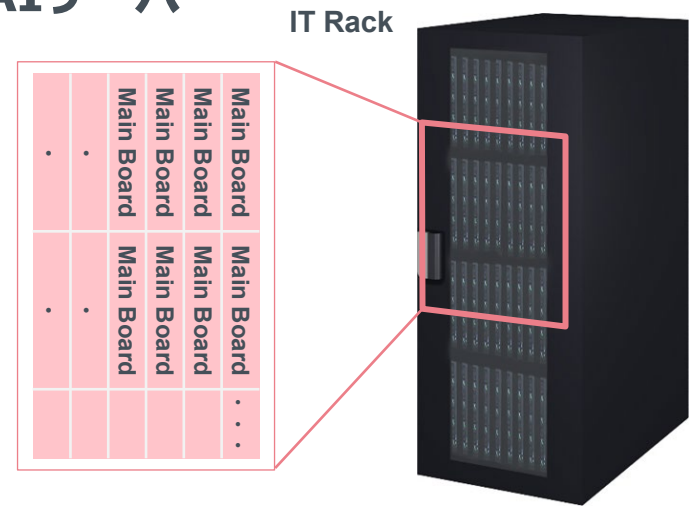
■既存サーバー



Power	600pcs
Analog	300pcs
Main Board搭載構造	**平積み**
Main Board数	18Tray
消費電力	13kW

■次世代AIサーバー

（2027年~）



Power	**22,000pcs**	**36倍**
Analog	**17,000pcs**	**56倍**
Main Board搭載構造	**縦置き**	
Main Board数	72Tray	**4倍**
消費電力	1,000kW	**72倍**

© ROHM Co., Ltd.

ロームの勝ち筋（競合優位性）

多彩なパワー・アナログ製品をラインアップし、お客様の希望する構成にあったソリューションを提供可能

Power Technology

EcoSiC　EcoGaN　EcoMOS

・業界TopクラスのFOM
・業界TopのWide SOA耐量

- SiC
- GaN HEMT
- Si

Power Technology ∞ Analog Technology

Analog Technology

Nano Pulse Control　Nano Cap

- MPC+DrMOS
- HSC
- SSD PMIC

・業界Topの高周波技術
・業界Topの高速応答技術

アジア唯一のワンストップメーカーとしてAIサーバーにおけるトッププレイヤーと協業

NVIDIA

800V電力供給システムで協業

DELTA



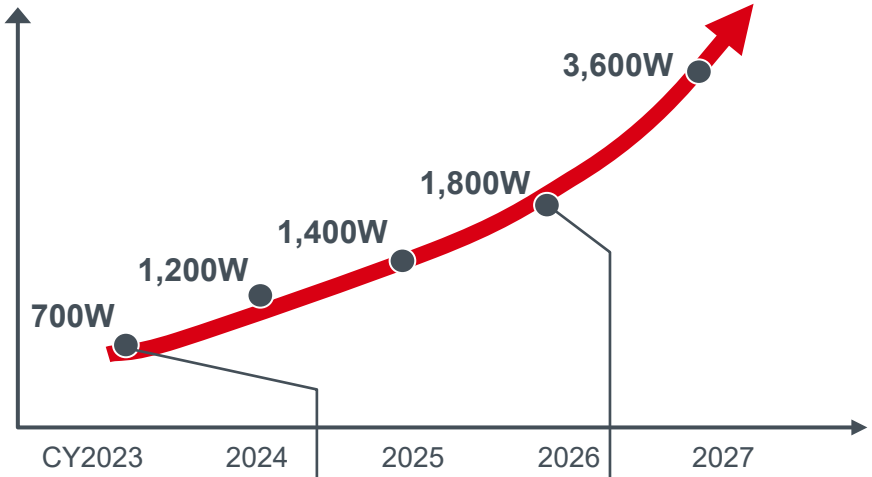
電源システム

© ROHM Co., Ltd.

世界最高性能のDrMOS

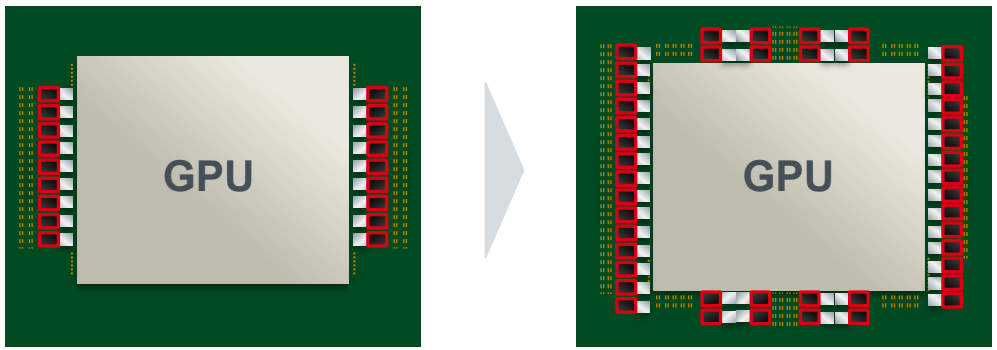
市場動向と使用数量

■ GPU消費電力推移 ※ローム想定



■ DrMOS使用数量

□：DrMOS搭載箇所

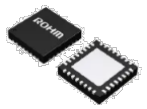


DrMOS: ～20　　DrMOS: ～50

ROHMの貢献

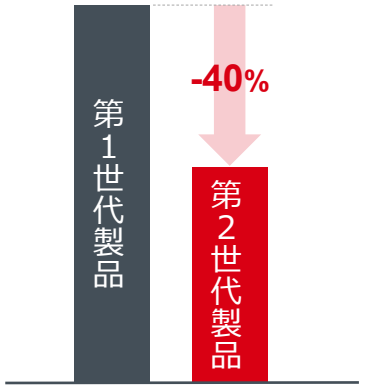
■ 次世代電源を支える高効率・高密度・高速応答MPC+DrMOS開発

第1世代　現行GPU向けにソリューションを完成

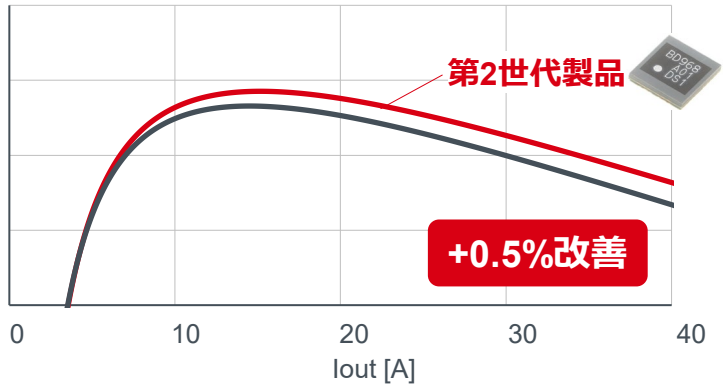
MPC	DrMOS	
16phaseコントローラ	100A DrMOS (6V入力)	90A DrMOS (12V入力)
		
BD964A01	BD965A01	BD966A01

第2世代　次世代GPU向け世界最高性能を達成*1

デバイス単体性能*2



アプリケーション性能（効率）

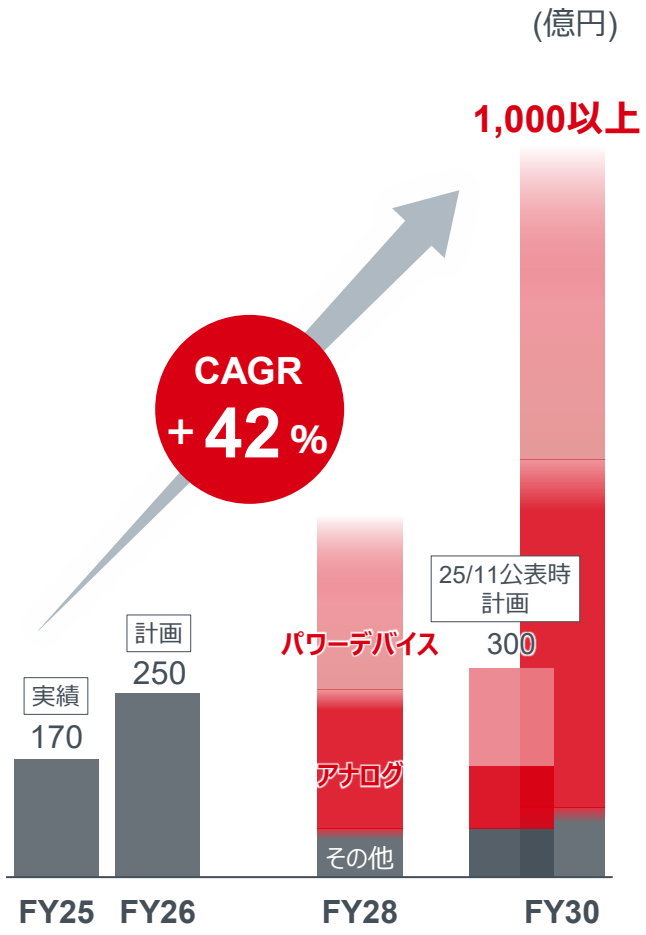


*1:2026年4月ROHM調べ　*2:デバイス単体性能 = Ron*Area

サーバー向けビジネスの売上目標

AIサーバー向けを中心とした、ローム各製品の採用拡大および新製品開発を本格化

サーバー向け売上目標と進捗



製品ラインアップ



Power Supply

AC-DC: AC / 800V + DC-DC: 800V / 800V

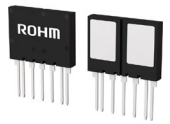
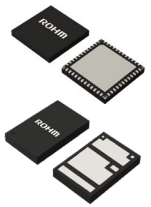
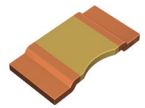
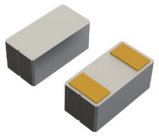
EcoSiC

800V$_{DC}$

Main board

DC-DC: 800V / IBV + DC-DC: IBV / xV + CPU・GPU + HDD/SSD

EcoGaN EcoMOS

Power				Analog			Others	
SiC MOSFET	GaN HEMT	Si MOSFET		MPC + DrMOS	HSC	SSD PMIC	Shunt Resistors	Si Capacitor
								
DOT-247	GNP2070TD-Z	RY7P250BM	RS7N200BH		BD12780MUV	BD72649GWV		
Low Ron	Low FOM*1	Wide SOA/Low Ron		High speed control	High speed response	High efficiency	Small and High accurate TCR	Low loss
↑	→	↑		↑	↗	↗	↗	↗

（25/11公表時比） ↑ 採用拡大および新製品開発を本格化 ↗ 採用拡大中 → 採用計画通り

*1:FOM(Figure of merit) = Ron*Qoss

© ROHM Co., Ltd.

事業・経営統合

© ROHM Co., Ltd.

デンソーによる株式取得提案に関する経緯／今後の協業について

（4月28日　適時開示）

＜経緯・検討プロセス＞

・デンソーから株式取得に関する提案を受領後、**独立社外取締役等で構成される特別委員会を設置**
・**企業価値の向上および株主共同利益の確保の観点から、公正かつ慎重に検討**
・書面による質疑応答およびデンソーとの複数回にわたる真摯な協議を実施
・両社で提案に関する理解は深まったものの、当社および特別委員会として提案に賛同する結論には至らず
・デンソーによる**総合的な検討の結果、提案は取下げられ、当社としても検討を終了**

＜両社の共通認識＞

・次世代モビリティやカーボンニュートラル社会の実現に向けて、
両社の強みを組み合わせた**共創は、技術・製造両面の競争力強化**につながり、
自動車、ならびに民生・産業機器分野における提供価値を向上させ得るとの認識を共有
・製品開発・供給等の協業施策や人的交流を通じて、**共創活動をこれまで以上に進展**させていくことを合意

＜今後の方針＞

・既存の戦略的パートナーシップに基づく協業の可能性について協議を継続
アナログICを中心に、車載・民生・産業機器分野での製品開発・供給等の協業および人的交流を推進

© ROHM Co., Ltd.

東芝D＆S 半導体事業および三菱電機 パワーデバイス事業との事業・経営統合

（3月27日　適時開示）

国際競争激化により、半導体市場で持続的に成長するためには、技術力・生産規模・供給体制の強化が必要不可欠。加えて、地政学リスクにより、サプライチェーン強靭化への要請も高まる。

パワーデバイス事業の事業・経営統合に関する協議開始

ROHM SEMICONDUCTOR

TOSHIBA

東芝デバイス＆ストレージ
半導体事業

MITSUBISHI ELECTRIC

三菱電機
パワーデバイス事業



ロームの目指す姿

半導体技術で存在感を示すグローバル企業へ

~パワー・アナログ半導体の分野で世界トップ10~

日本だけでなく世界の顧客に対して
「存在感」を示すことの出来ている企業を目指す

© ROHM Co., Ltd.

資本政策

東芝D＆S半導体事業および三菱電機パワーデバイス事業との事業・経営統合が最終契約の締結に至った場合には、資本政策含め中期経営計画の見直しを実施

財務戦略の見直し

キャッシュ創出	業績回復、CCC改善による運転資本の縮減、非事業性資産の適正化、投資有価証券売却
戦略投資	戦略投資の具体化に伴い、資金調達により投資枠を拡大
株主還元	連結配当性向30%以上 東芝へのLP出資のリターン実現時には自己株式取得含む追加還元を実施
設備投資	適正水準へ抑制（生産拠点再編、維持管理、R&D）
財務規律	財務レバレッジ活用により目標とするD/E=0.5を一時的に超過（D/E＜0.7）
手元資金	売上の3ヶ月分程度へ圧縮

キャッシュアロケーション（FY26～FY28 3年累計）



※FY2025末時点

ご注意事項・お問い合わせ先

＜ご注意事項＞

1. 当資料は投資分析を目的として作成しておりますので、投資分析にのみ
   ご使用ください。

2. 2026年度通期の予想は、現時点で得られた情報にもとづいております。
   従って、業況の変化などにより記載の予想と大きく異なる場合があります。

＜お問い合わせ先＞

ローム株式会社　IR室
〒615-8585　京都市右京区西院溝崎町21
E-mail：ir@rohm.co.jp

© ROHM Co., Ltd.



Electronics for the Future

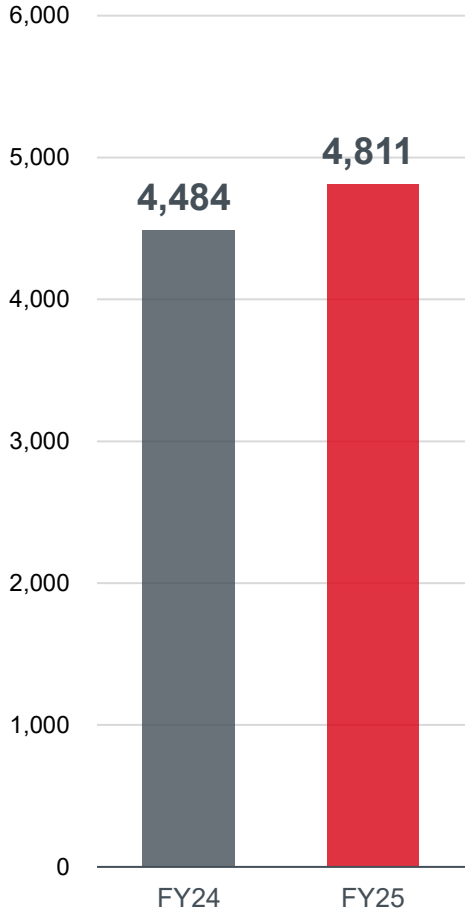
補足資料

［2025年度 通期実績］市場別売上の変動要因（YoY）

（単位：億円）

通期売上高

+7.3%



自動車

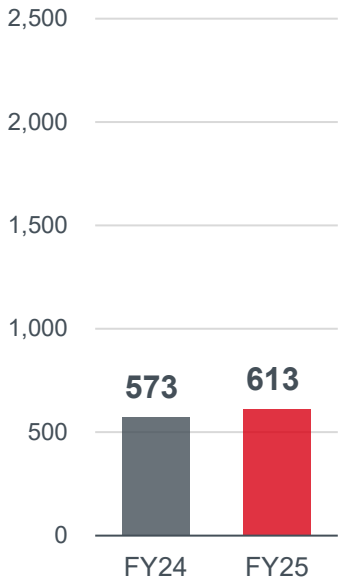
+5.8%



インフォテインメント	▲26
ボディ	+44
パワートレイン	▲13
安全走行ADAS	▲0
xEV	+101
その他	+25

産機

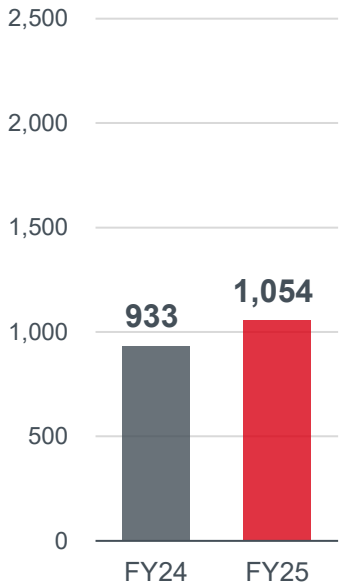
+7.0%



FA	+19
エネルギー	▲2
ホームビルディング	▲13
その他	+37

民生

+13.0%



AV関連	▲3
家電	▲16
その他	+140

通信

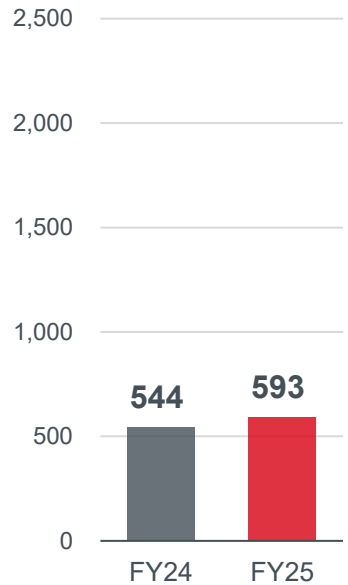
▲7.0%



スマホ&モバイル	▲18
基地局&インフラ	+2
有線通信	+2

コンピュータ & ストレージ

+8.9%



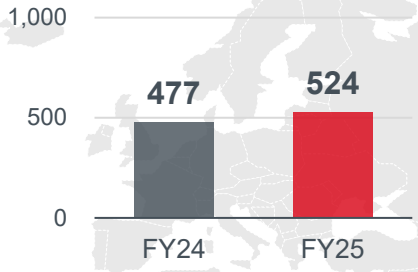
PC&サーバー	+36
決済端末	+1
事務機	+12

［2025年度 通期実績］国籍別売上の変動要因（YoY）

通期売上高	FY2024 実績	FY2025 実績	
	4,484億円	4,811億円	+7.3%

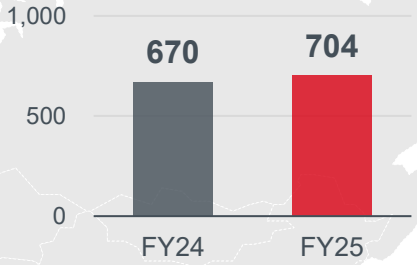
海外売上高比率	FY2024 実績	FY2025 実績
	47.7%	47.6%

欧州 +9.8%



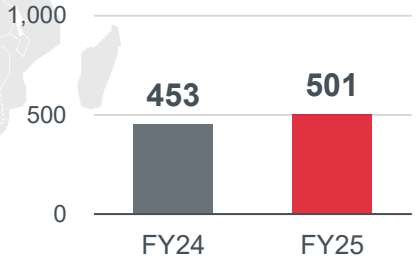
自動車	+45	通信	+0
産機	▲0	C&S	+6
民生	▲3		

中国 +5.1%



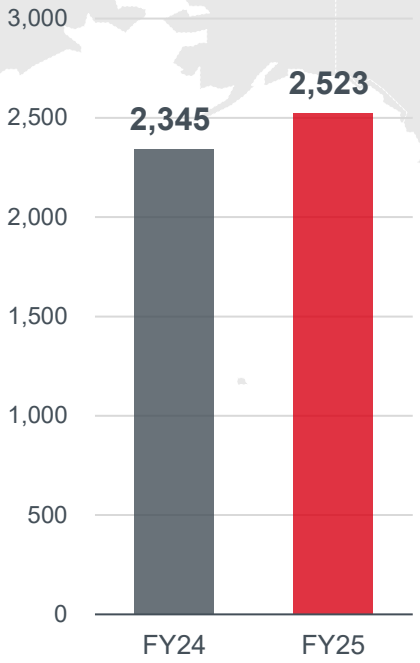
自動車	+40	通信	+5
産機	▲9	C&S	+4
民生	▲6		

その他アジア +10.6%



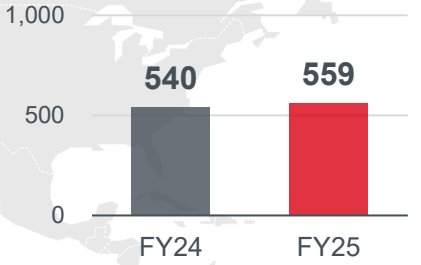
自動車	+5
産機	+11
民生	▲3
通信	▲3
C&S	+38

日本 +7.6%



自動車	+28	通信	▲8
産機	+16	C&S	+6
民生	+136		

米州 +3.6%



自動車	+14	通信	▲9
産機	+23	C&S	▲5
民生	▲4		

※取引先企業の国籍別 売上を集計 (単位：億円)

© ROHM Co., Ltd.

［2025年度 通期実績］セグメント利益（YoY）

（単位：億円）

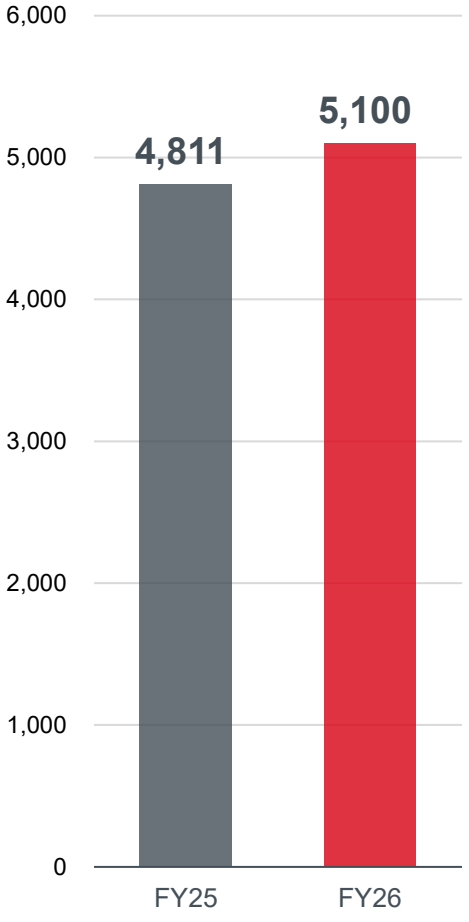
		FY2025 実績	FY2024 実績	増減額	増減率
LSI	売上	2,183	2,038	+146	+7.1%
	セグメント利益	245	▲7	+253	-
	（利益率）	(11.2%)	(▲0.4%)	-	-
半導体素子	売上	2,052	1,870	+182	+9.7%
	セグメント利益	▲227	▲458	+232	-
	（利益率）	(▲11.1%)	(▲24.5%)	-	-
モジュール	売上	315	325	▲10	▲3.0%
	セグメント利益	35	26	+8	+30.9%
	（利益率）	(11.2%)	(8.3%)	-	-
その他	売上	259	250	+9	+3.5%
	セグメント利益	41	25	+16	+62.6%
	（利益率）	(15.8%)	(10.1%)	-	-

［2026年度 通期計画］市場別売上の変動要因（YoY）

（単位：億円）

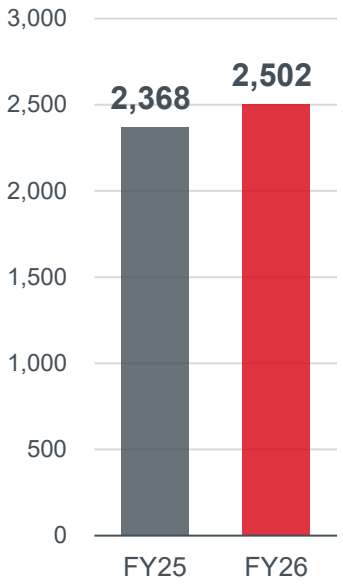
通期売上高

+6.0%



自動車

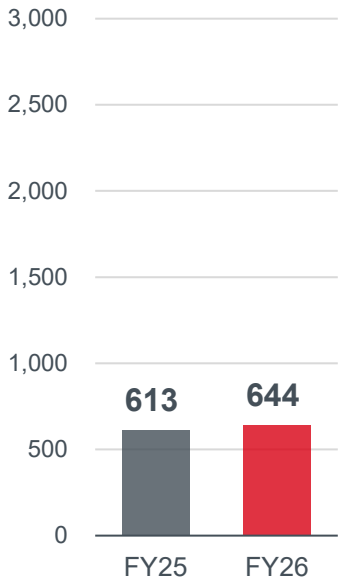
+5.6%



インフォテインメント	▲0
ボディ	+5
パワートレイン	▲5
安全走行ADAS	▲12
xEV	+132
その他	+13

産機

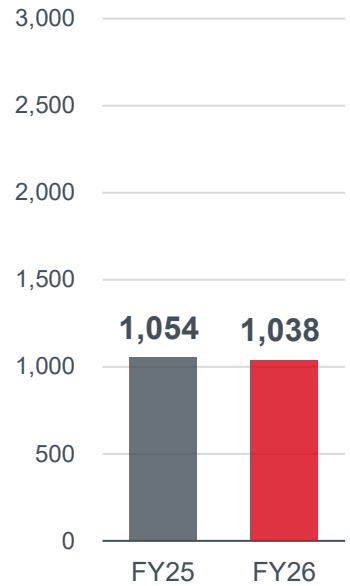
+5.0%



FA	+8
エネルギー	▲12
ホームビルディング	+29
その他	+6

民生

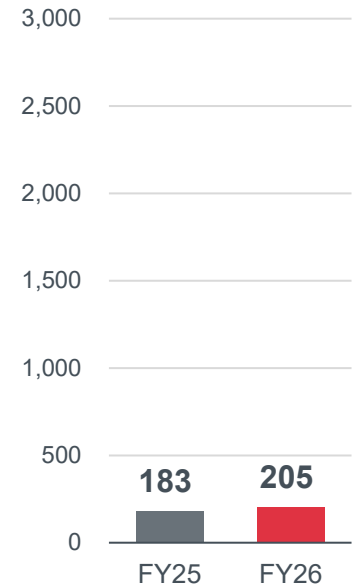
▲1.5 %



AV関連	▲0
家電	▲24
その他	+8

通信

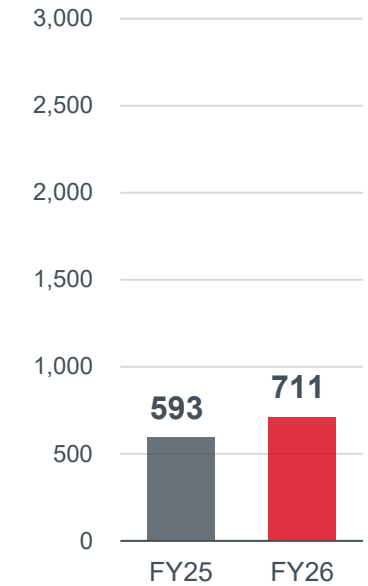
+12.2%



スマホ&モバイル	+19
基地局&インフラ	+3
有線通信	▲0

コンピュータ & ストレージ

+19.9%



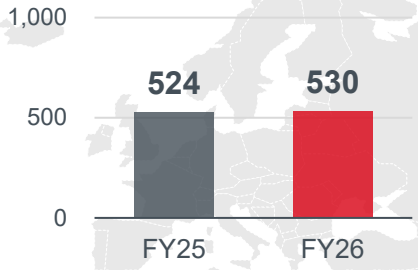
PC&サーバー	+129
決済端末	▲21
事務機	+10

［2026年度 通期計画］国籍別売上の変動要因（YoY）

通期売上高	FY2025 実績	FY2026 計画	
	4,811億円	5,100億円	+6.0%

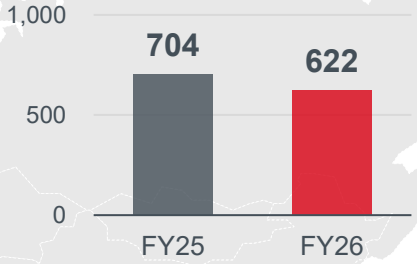
海外売上高比率	FY2025 実績	FY2026 計画
	47.6%	46.7%

欧州 +1.0%



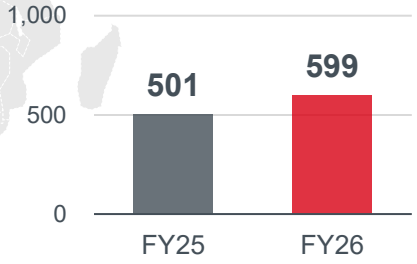
自動車	+5	通信	+1
産機	▲3	C&S	+2
民生	+1		

中国 ▲11.7%



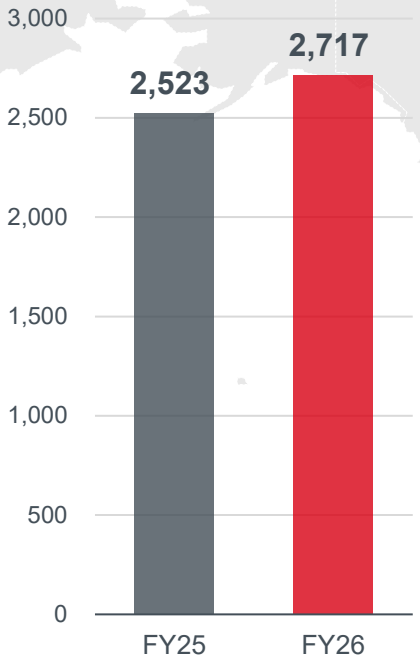
自動車	▲44	通信	+1
産機	▲11	C&S	+1
民生	▲30		

その他アジア +19.7%



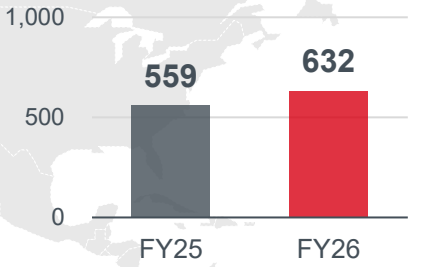
自動車	+24
産機	+1
民生	+5
通信	▲2
C&S	+70

日本 +7.7%



自動車	+141	通信	▲1
産機	+42	C&S	+7
民生	+5		

米州 +13.0%



自動車	+6	通信	+23
産機	+2	C&S	+38
民生	+3		

※取引先企業の国籍別 売上を集計 (単位：億円)

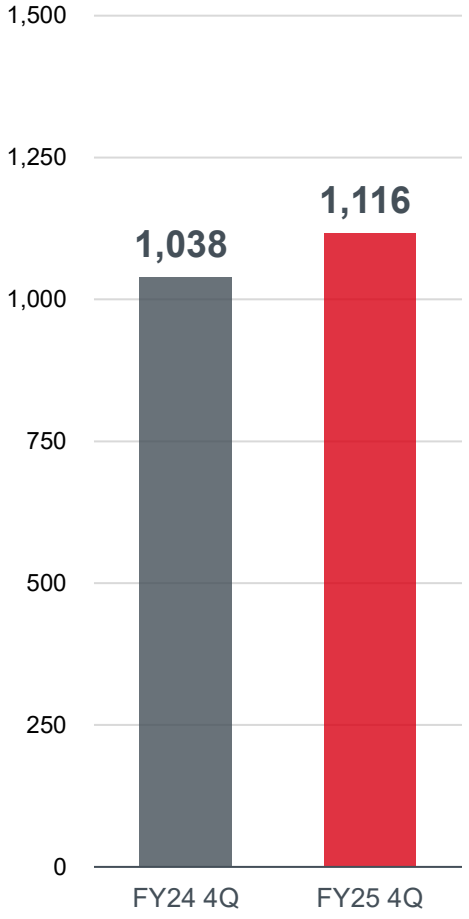
© ROHM Co., Ltd.

［2025年度 第4四半期実績］市場別売上の変動要因（YoY）

（単位：億円）

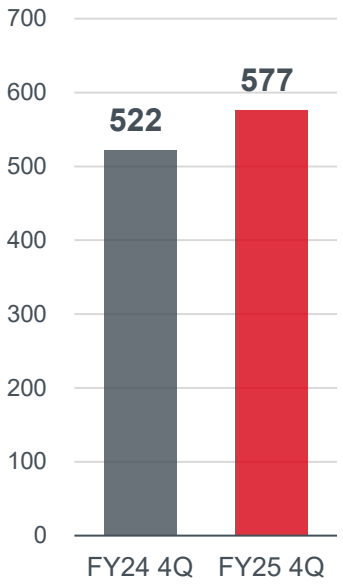
通期売上高

+7.5%



自動車

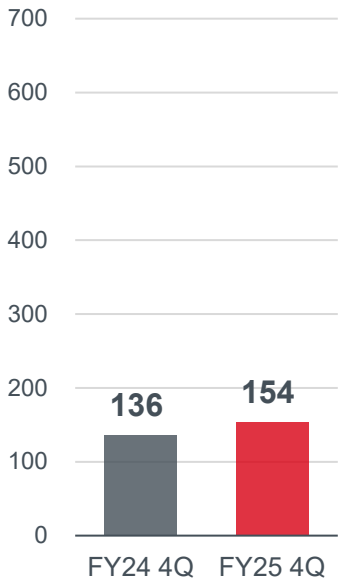
+10.4%



インフォテインメント	+1
ボディ	+11
パワートレイン	▲3
安全走行ADAS	+4
xEV	+33
その他	+8

産機

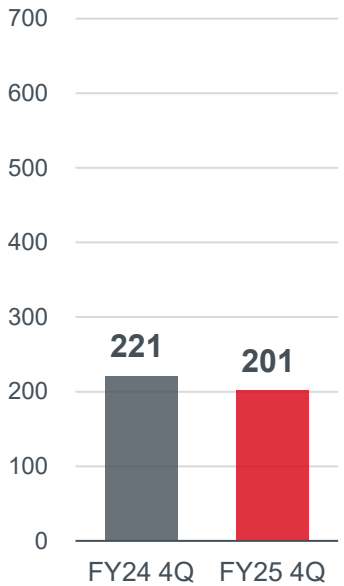
+12.9%



FA	+2
エネルギー	▲5
ホームビルディング	+5
その他	+15

民生

▲8.8%



AV関連	▲1
家電	▲12
その他	▲7

通信

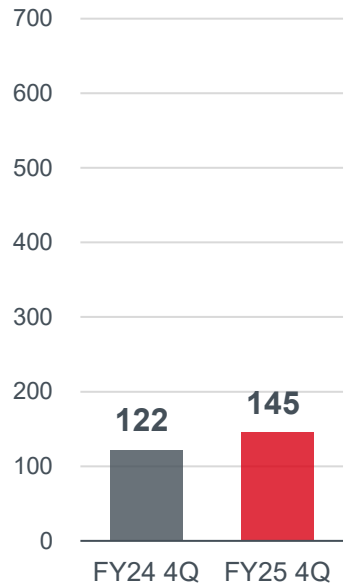
+6.2%



スマホ&モバイル	+1
基地局&インフラ	+0
有線通信	+1

コンピュータ & ストレージ

+19.3%



PC&サーバー	+21
決済端末	▲1
事務機	+3

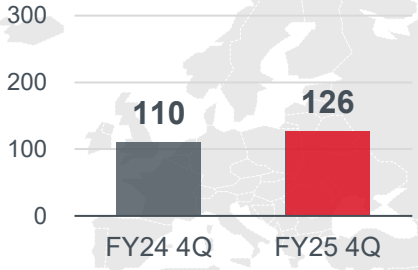
© ROHM Co., Ltd.

［2025年度 第4四半期実績］国籍別売上の変動要因（YoY）

通期売上高	FY2024 4Q実績	FY2025 4Q実績	
	1,038億円	1,116億円	+7.5%

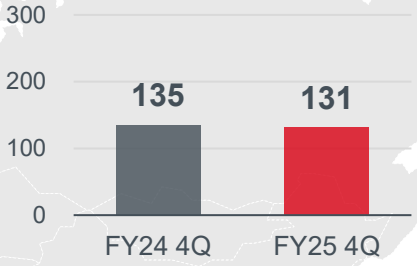
海外売上高比率	FY2024 4Q実績	FY2025 4Q実績
	44.8%	46.6%

欧州 +14.6%



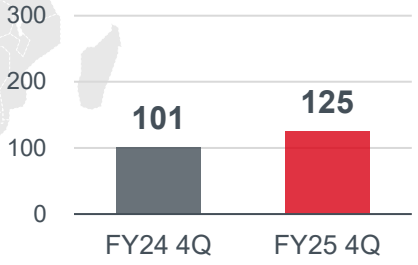
自動車	+15	通信	+0
産機	+0	C&S	+2
民生	▲1		

中国 ▲2.8%



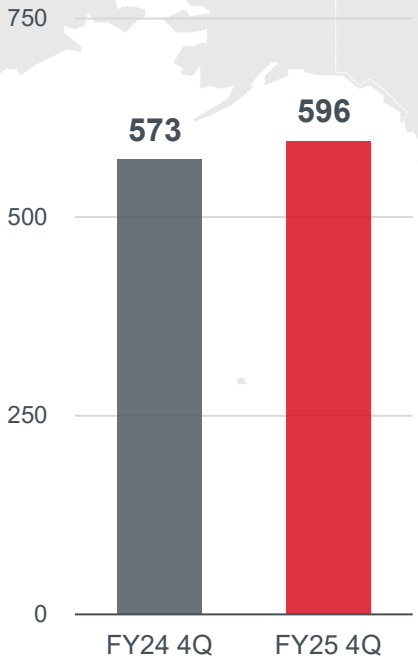
自動車	+12	通信	+1
産機	▲4	C&S	▲1
民生	▲11		

その他アジア +23.5%



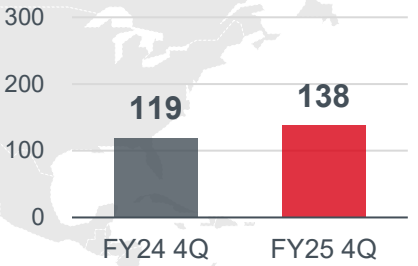
自動車	+2
産機	+0
民生	+2
通信	+0
C&S	+19

日本 +4.1%



自動車	+19	通信	▲2
産機	+13	C&S	+2
民生	▲9		

米州 +15.7%



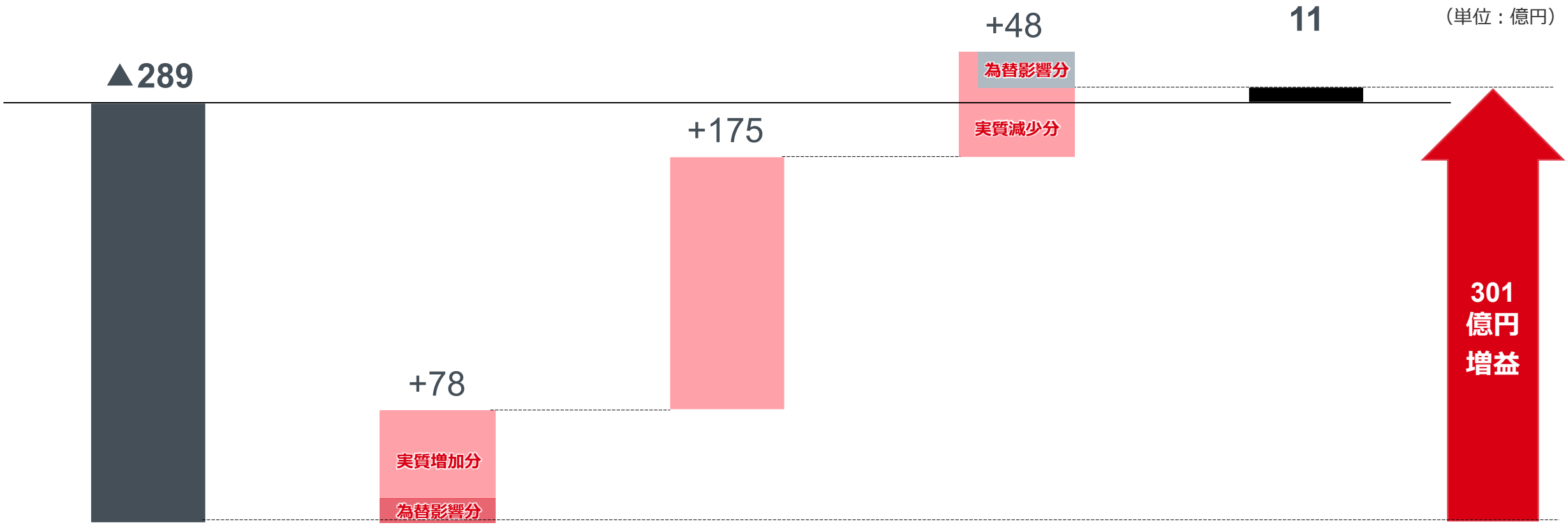
自動車	+7	通信	+3
産機	+9	C&S	+1
民生	▲1		

※取引先企業の国籍別 売上を集計 (単位：億円)

© ROHM Co., Ltd.

［2025年度 第4四半期実績］営業利益 増減分析（YoY）

（単位：億円）



売上増加	+78
為替影響	+17
実質増加	+61

材料費及び在庫の影響	+175
材料費	▲65
在庫の影響	+240

固定費の減少	+48
為替影響	▲24
実質減少	+72

市場別内訳

自動車	+54	通信	+2
産機	+18	C&S	+23
民生	▲19		

製造原価

労務費	▲9
償却費	+50
経費	+9

販管費

研究開発費	+5
その他	▲7

© ROHM Co., Ltd.

［2025年度 第4四半期実績］セグメント利益（YoY）

（単位：億円）

		FY2025 4Q 実績	FY2024 4Q 実績	増減額	増減率
LSI	売上	490	479	+11	+2.3%
	セグメント利益	45	▲47	+94	-
	（利益率）	(9.4%)	(▲9.9%)	-	-
半導体素子	売上	494	429	+65	+15.1%
	セグメント利益	▲62	▲254	+192	-
	（利益率）	(▲12.6%)	(▲59.2%)	-	-
モジュール	売上	67	68	▲2	▲3.2%
	セグメント利益	5	▲0	+5	-
	（利益率）	(7.7%)	(▲0.3%)	-	-
その他	売上	65	60	+4	+7.3%
	セグメント利益	7	6	+1	+21.9%
	（利益率）	(11.9%)	(10.4%)	-	-

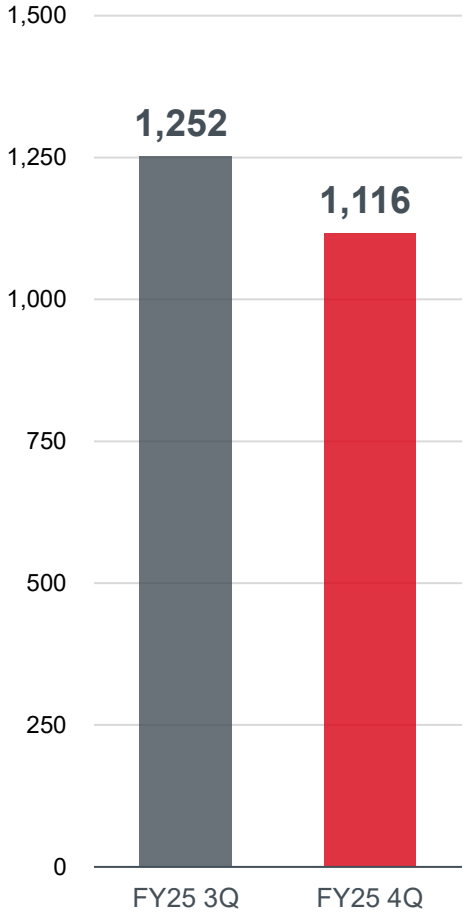
© ROHM Co., Ltd.

［2025年度 第4四半期実績］市場別売上の変動要因（QoQ）

（単位：億円）

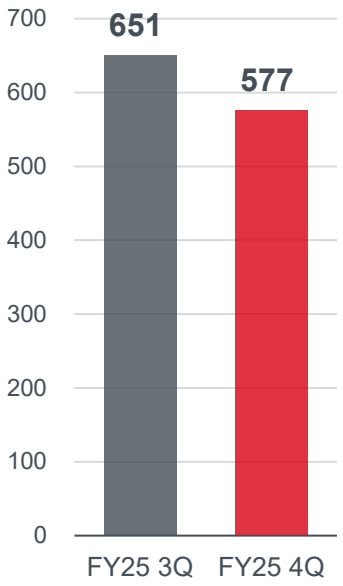
通期売上高

▲10.9%



自動車

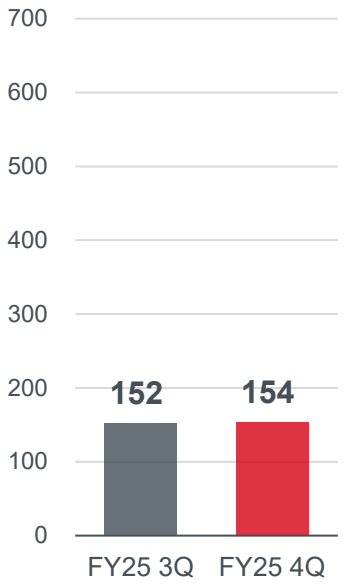
▲11.4%



インフォテインメント	▲6
ボディ	▲8
パワートレイン	▲2
安全走行ADAS	▲1
xEV	▲51
その他	▲5

産機

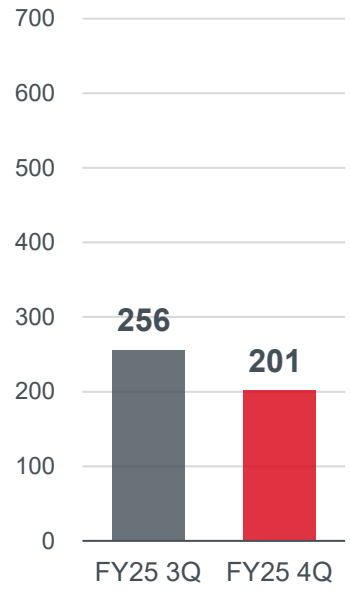
+1.0%



FA	▲2
エネルギー	▲5
ホームビルディング	+8
その他	+0

民生

▲21.3%



AV関連	+1
家電	▲12
その他	▲44

通信

▲12.8%



スマホ&モバイル	▲4
基地局&インフラ	▲2
有線通信	+0

コンピュータ & ストレージ

▲2.6%



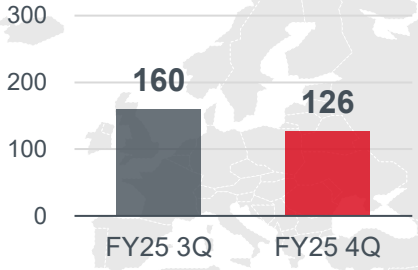
PC&サーバー	+0
決済端末	▲8
事務機	+4

［2025年度 第4四半期実績］国籍別売上の変動要因（QoQ）

通期売上高	FY2025 3Q実績	FY2025 4Q実績	
	1,252億円	1,116億円	▲10.9%

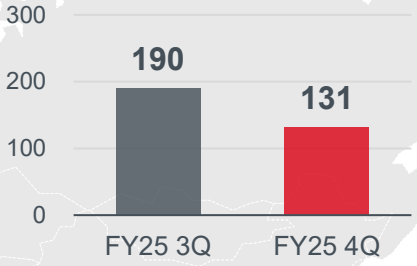
海外売上高比率	FY2025 3Q実績	FY2025 4Q実績
	49.8%	46.6%

欧州 ▲20.8%



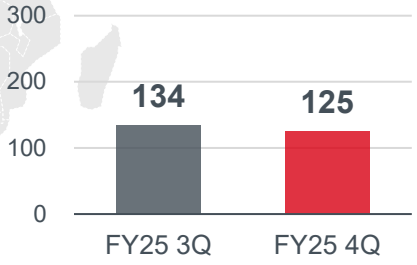
自動車	▲37	通信	+0
産機	+2	C&S	+2
民生	▲0		

中国 ▲30.8%



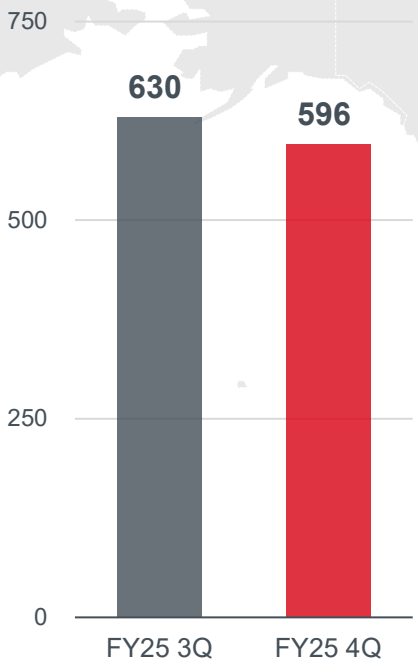
自動車	▲34	通信	▲2
産機	▲5	C&S	▲6
民生	▲12		

その他アジア ▲6.7%



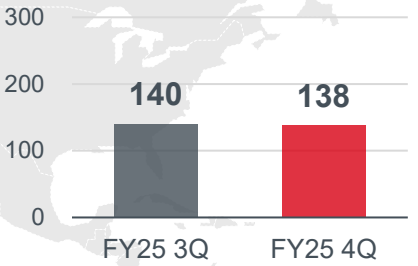
自動車	▲5
産機	▲6
民生	+0
通信	▲1
C&S	+3

日本 ▲5.3%



自動車	▲1	通信	▲0
産機	+8	C&S	+0
民生	▲41		

米州 ▲1.6%

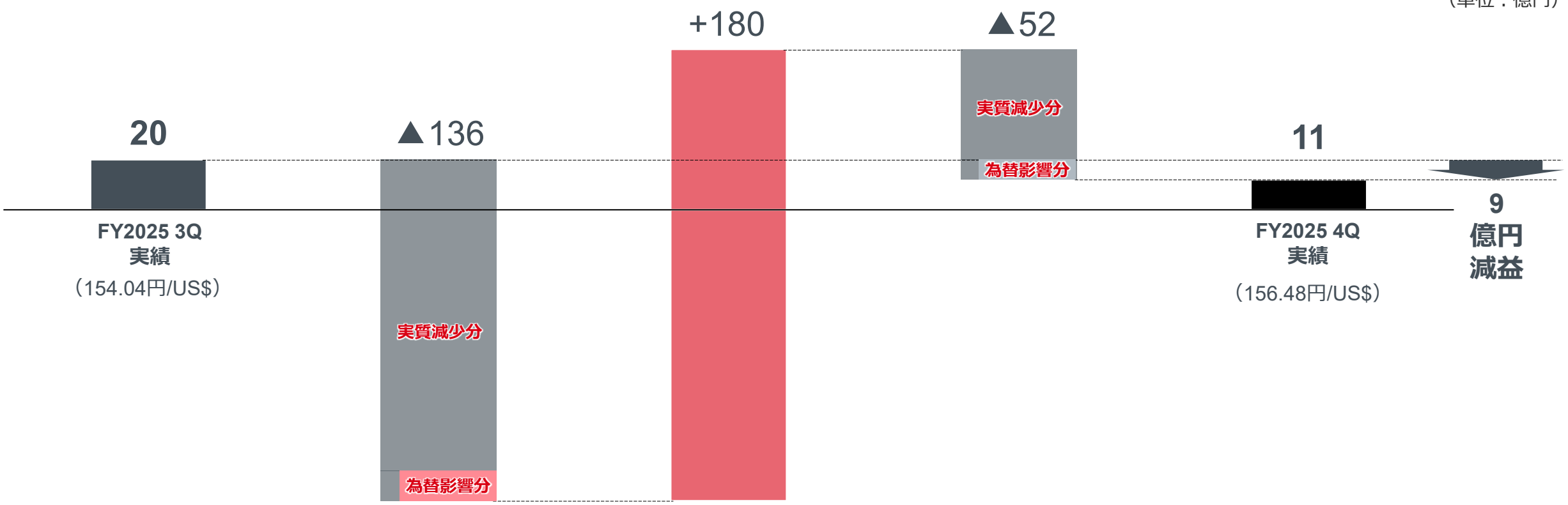


自動車	+3	通信	▲2
産機	+2	C&S	▲3
民生	▲2		

※取引先企業の国籍別 売上を集計 (単位：億円)

［2025年度 第4四半期実績］営業利益 増減分析（QoQ）

（単位：億円）



売上増加	▲136
為替影響	+12
実質減少	▲148

材料費及び在庫の影響	+180
材料費	+86
在庫の影響	+94

固定費の減少	▲52
為替影響	▲8
実質減少	▲44

市場別内訳

自動車	▲74	通信	▲6
産機	+2	C&S	▲4
民生	▲54		

製造原価

労務費	+4
償却費	▲9
経費	▲9

販管費

研究開発費	▲26
その他	▲12

© ROHM Co., Ltd.

［2025年度 第4四半期実績］セグメント利益（QoQ）

（単位：億円）

		FY2025 4Q 実績	FY2025 3Q 実績	増減額	増減率
LSI	売上	490	551	▲61	▲11.1%
	セグメント利益	45	69	▲24	▲34.1%
	（利益率）	(9.4%)	(12.7%)	-	-
半導体素子	売上	494	558	▲64	▲11.5%
	セグメント利益	▲62	▲66	+5	-
	（利益率）	(▲12.6%)	(▲12.0%)	-	-
モジュール	売上	66	77	▲11	▲14.2%
	セグメント利益	5	5	▲1	▲12.0%
	（利益率）	(7.7%)	(7.5%)	-	-
その他	売上	65	65	▲0	▲0.1%
	セグメント利益	7	12	▲5	▲39.5%
	（利益率）	(11.9%)	(19.6%)	-	-

© ROHM Co., Ltd.